

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-39185

(P2005-39185A)

(43) 公開日 平成17年2月10日 (2005.2.10)

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
H 0 1 L 21/68	H 0 1 L 21/68	4 K 0 3 0
B 6 5 G 49/00	B 6 5 G 49/00	5 F 0 0 4
H 0 1 L 21/3065	H 0 1 L 21/302	5 F 0 3 1
// C 2 3 C 16/44	C 2 3 C 16/44	F

審査請求 未請求 請求項の数 25 O L (全 29 頁)

(21) 出願番号	特願2003-422821 (P2003-422821)	(71) 出願人	000219967 東京エレクトロン株式会社
(22) 出願日	平成15年12月19日 (2003.12.19)		東京都港区赤坂五丁目3番6号
(31) 優先権主張番号	特願2003-179435 (P2003-179435)	(74) 代理人	100081880 弁理士 渡部 敬彦
(32) 優先日	平成15年6月24日 (2003.6.24)		小澤 潤
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内
		(72) 発明者	高橋 岳
			東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内
		Fターム (参考)	4K030 CA04 CA12 DA08 DA09 GA12 JA09 KA39 KA41 5F004 AA16 BA19 BC05 BC06 EA40

最終頁に続く

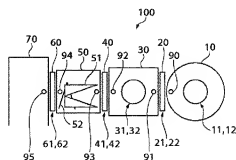
(54) 【発明の名称】 被処理体処理装置、その被処理体処理方法、圧力制御方法、被処理体搬送方法、及び搬送装置

(57) 【要約】

【課題】 複数の処理を効率良く行うことができる真空処理装置を提供する。

【解決手段】 真空処理装置100は、被処理体を処理する第1の真空処理室10と第2の真空処理装置30とが連通自在且つ縦列に連結されており、さらに、被処理体を真空処理室10、30のそれぞれの間で搬入し、搬出する搬送機構52を備えたロードロック室50が第2の真空処理装置30に連通自在に縦列に連結されている。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

被処理体を処理する被処理体処理装置において、
連通自在且つ縦列に連結された、前記被処理体を処理する複数の処理室と、
前記複数の処理室と連通自在に連結され、前記被処理体を前記複数の処理室のそれぞれとの間で搬出入する搬送機構を備えたロードロック室とを備え、
前記複数の処理室のうち少なくとも1つは真空処理室であり、前記ロードロック室は、前記複数の処理室と縦列をなす位置に配置されることを特徴とする被処理体処理装置。

【請求項 2】

被処理体を処理する被処理体処理装置において、
連通自在且つ縦列に連結された、前記被処理体にC O R処理を施すC O R処理室及び前記被処理体に他の処理を施す少なくとも1つの真空処理室と、
前記複数の処理室と連通自在に連結され、前記被処理体を前記複数の処理室のそれぞれとの間で搬出入する搬送機構を備えたロードロック室とを備えることを特徴とする被処理体処理装置。

【請求項 3】

前記他の処理を施す少なくとも1つの真空処理室は、前記C O R処理室に連結され、前記C O R処理が施された被処理体に熱処理を施すための熱処理室であることを特徴とする請求項2記載の被処理体処理装置。

【請求項 4】

前記C O R処理室及び前記熱処理室は、常時に真空状態にあることを特徴とする請求項3記載の被処理体処理装置。

【請求項 5】

前記ロードロック室は、前記複数の処理室と縦列をなす位置に配置されたことを特徴とする請求項4記載の被処理体処理装置。

【請求項 6】

ロードロック室と、被処理体にC O R処理を施すC O R処理室と、前記C O R処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の被処理体処理方法であって、

第1の被処理体を前記ロードロック室に搬入する第1のロードロック室搬入ステップと

、
前記第1の搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第1の真空引きステップと、

前記真空引きが終了した後に、前記第1の被処理体を前記C O R処理室に搬入する第1のC O R処理室搬入ステップと、

前記C O R処理を開始するC O R処理開始ステップと、

前記C O R処理の間に第2の被処理体を前記ロードロック室に搬入する第2のロードロック室搬入ステップと、

前記第2の搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第2の真空引きステップと、

前記真空引きが終了した後に、前記C O R処理が終了してから前記第1の被処理体を前記C O R処理室から前記熱処理室に移動させる第1の移動ステップと、

前記第2の被処理体を前記ロードロック室から前記C O R処理室に移動させる第2の移動ステップと、

前記C O R処理室で前記C O R処理を開始し、前記熱処理室で前記熱処理を開始する同時処理開始ステップと、

前記熱処理が終了した後に前記熱処理室の前記第1の被処理体を前記ロードロック室に移す第3の移動ステップと、

大気搬送モジュール側のゲートを開き、前記ロードロック室内の前記第1の被処理体と前記大気搬送モジュールで待機している第3の被処理体とを入れ換える入換ステップとを

10

20

30

40

50

有することを特徴とする被処理体処理方法。

【請求項 7】

ロードロック室と、被処理体に C O R 処理する C O R 処理室と、前記 C O R 処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室と、前記被処理体を前記ロードロック室との間で搬出し搬入する大気搬送モジュールとを少なくとも有する被処理体処理装置の圧力制御方法であって、

前記熱処理室を真空引き中に、前記ロードロック室を大気状態にして前記 C O R 処理前の前記被処理体を前記大気搬送モジュールから前記ロードロック室に搬入する搬入ステップと、

前記熱処理室の真空引きを終了して前記ロードロック室を設定圧力まで真空引きするロードロック室真空引きステップと、

前記ロードロック室が前記設定圧力に到達した後、当該ロードロック室の真空引きを終了し、

ロードロック室内圧力 > 熱処理室内圧力

の条件を満たすように前記熱処理室を真空引きする熱処理室真空引きステップと、

前記条件が満たされた後に、前記ロードロック室と前記熱処理室とを連通する第 1 の連通ステップとを有することを特徴とする圧力制御方法。

【請求項 8】

被処理体に C O R 処理する C O R 処理室と、前記 C O R 処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の圧力制御方法であって、

前記熱処理室を排気しながら当該熱処理室内の圧力をモニタする圧力モニタステップと、

熱処理室内圧力 < C O R 処理室内圧力

の条件を満たすように前記 C O R 処理室内を排気する C O R 処理室排気ステップと、

前記条件が満たされた時点で、前記 C O R 処理室の排気を終了して、前記熱処理室と前記 C O R 処理室とを連通する連通ステップとを有することを特徴とする圧力制御方法。

【請求項 9】

前記第 1 の連通ステップに続いて、前記熱処理室を排気しながら当該熱処理室内の圧力をモニタする第 1 の圧力モニタステップと、

熱処理室内圧力 < C O R 処理室内圧力

の条件を満たすように C O R 処理室内を排気する C O R 処理室排気ステップと、

前記条件が満たされた時点で、前記 C O R 処理室の排気を終了して、前記熱処理室と前記 C O R 処理室とを連通する第 2 の連通ステップとを有することを特徴とする請求項 7 記載の圧力制御方法。

【請求項 10】

前記第 2 の連通ステップの後に、前記ロードロック室及び前記 C O R 処理室に流体を流入させる流入ステップを有することを特徴とする請求項 9 記載の圧力制御方法。

【請求項 11】

前記ロードロック室から前記熱処理室への流体の流量及び前記 C O R 処理室から前記熱処理室への流体の流量が等しいことを特徴とする請求項 10 記載の圧力制御方法。

【請求項 12】

前記 C O R 処理を施した被処理体を前記 C O R 処理室から搬出した後に、前記熱処理室及び前記 C O R 処理室を排気して前記 C O R 処理室の圧力を E S C 残留電荷除去のための除電圧力にする排気ステップを有することを特徴とする請求項 9 乃至 11 のいずれか 1 項に記載の圧力制御方法。

【請求項 13】

被処理体を処理する被処理体処理装置において、

前記被処理体に第 1 の処理を施す第 1 の処理室と、

該第 1 の処理室と連通自在に連結され且つ前記被処理体に第 2 の処理を施す第 2 の処理室と、

前記複数の処理室の間に介在して前記複数の処理室のそれぞれと連通自在に連結されると共に、前記被処理体を前記複数の処理室のそれぞれとの間で搬出入する搬送機構を有するロードロック室とを備えることを特徴とする被処理体処理装置。

【請求項 14】

前記第 2 の処理室は、前記第 1 の処理が施された被処理体に冷却処理を施すための冷却処理室であることを特徴とする請求項 13 記載の被処理体処理装置。

【請求項 15】

前記第 1 の処理室は常時に真空状態にあり、且つ前記第 2 の処理室は常時に大気圧状態にあることを特徴とする請求項 14 記載の被処理体処理装置。

【請求項 16】

前記ロードロック室は前記第 1 の処理室及び前記第 2 の処理室と列をなす位置に配置されたことを特徴とする請求項 15 記載の被処理体処理装置。

【請求項 17】

ロードロック室と、被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記真空処理が施された被処理体に冷却処理を施す大気処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の被処理体処理方法であって、

大気搬送モジュールから被処理体を前記ロードロック室に搬入するロードロック室搬入ステップと、

前記ロードロック室搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第 1 の真空／大気の切換ステップと、

前記第 1 の真空／大気の切換ステップの後に、前記被処理体を前記真空処理室に搬入する真空処理室搬入ステップと、

前記真空処理室に搬入された被処理体に前記真空処理を施す真空処理ステップと、

前記真空処理が施された被処理体を前記ロードロック室に搬出するロードロック室搬出ステップと、

前記ロードロック室搬出ステップの後に前記ロードロック室を大気開放する第 2 の真空／大気の切換ステップと、

前記ロードロック室から前記被処理体を前記大気処理室に搬出する大気処理室搬出ステップと、

前記大気処理室に搬出された被処理体に前記冷却処理を施す大気処理ステップと、

前記冷却処理が施された被処理体を前記大気搬送モジュールに搬出する大気搬送モジュール搬出ステップとを有することを特徴とする被処理体処理方法。

【請求項 18】

被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室と、前記被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記真空処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、

前記被処理体を前記ロードロック室に搬入するロードロック室搬入ステップと、

前記ロードロック室搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする真空引きステップと、

前記真空引きが終了した後に、前記被処理体を前記真空処理室に搬入する真空処理室搬入ステップと、

前記真空処理室搬入ステップの後に、前記真空処理を開始する真空処理開始ステップと、

前記真空処理が終了してから前記被処理体を前記真空処理室から前記熱処理室に移動させる第 1 の移動ステップと、

前記熱処理室で前記熱処理を開始する熱処理開始ステップと、

前記熱処理が終了した後に前記熱処理室の前記被処理体を前記ロードロック室に移す第 2 の移動ステップと、

大気搬送モジュール側のゲートを開き、前記被処理体を前記大気搬送モジュールに搬出する大気搬送モジュール搬出ステップとを有することを特徴とする被処理体搬送方法。

10

20

30

40

50

【請求項 19】

第1の載置台を有し、該第1の載置台上に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室と、第2の載置台を有し、該第2の載置台上に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記複数の処理室と連通するように配設され且つ前記被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室と、前記搬送手段を制御する制御装置とを備え、前記搬送手段が前記被処理体を保持すると共に前記複数の処理室内を自在に移動する被処理体保持部を有し、前記被処理体保持部が前記被処理体の有無に関する情報を検知する第1の検知手段を有し、前記第1及び第2の載置台のうち少なくとも1つが、前記被処理体の有無に関する情報を検知する第2の検知手段を有し、前記制御装置が前記検知された情報に基づいて前記被処理体の位置を検出する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、

初期位置における前記被処理体の中心及び前記載置台の中心の第1の相対的な位置関係を検出する第1の位置関係検出ステップと、

前記検出された第1の相対的な位置関係に基づいて前記被処理体の搬送経路を決定し且つ該決定された搬送経路に沿って前記被処理体を搬送する搬送ステップと、

前記載置台へ搬送された前記被処理体の中心及び前記初期位置における前記被処理体の中心の第2の相対的な位置関係を検出する第2の位置関係検出ステップと、

前記第1及び第2の相対的な位置関係の差に基づいて前記被処理体の位置を補正する位置補正ステップとを有することを特徴とする被処理体搬送方法。

【請求項 20】

前記位置を補正された被処理体の基準面の位置を所定の位置に合わせるべく前記被処理体保持部が前記被処理体を保持したまま回転する被処理体保持部回転ステップを有することを特徴とする請求項 19 記載の被処理体搬送方法。

【請求項 21】

前記初期位置における前記被処理体の中心は、搬送前の前記ロードロック室における前記被処理体の中心であることを特徴とする請求項 19 又は 20 記載の被処理体搬送方法。

【請求項 22】

第1の載置台を有し、該第1の載置台上に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室に連通するように連結されると共に、第2の載置台を有し、該第2の載置台上に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室に前記熱処理室を介して連通するように連結され、前記被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室を備え、前記搬送手段は、少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続される搬送アームと、前記2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続され且つ前記被処理体を保持する被処理体保持部とを有する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、

前記被処理体保持部が前記一方の腕状部材における前記他端を中心として前記被処理体の表面と平行に回転すると共に、前記一方の腕状部材が前記一端を中心として前記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として前記表面と平行に回転する被処理体移動ステップを有することを特徴とする被処理体搬送方法。

【請求項 23】

前記被処理体移動ステップでは、前記第1及び第2の載置台の配列方向に沿って前記被処理体を移動させるべく前記2つの腕状部材及び前記被処理体保持部が協働して回転することを特徴とする請求項 22 記載の被処理体搬送方法。

【請求項 24】

第1の載置台を有し、該第1の載置台上に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室に連通するように連結されると共に、第2の載置台を有し、該第2の載置台上に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室に前記熱処理室を介して連通するように連結されるロードロック室に配設される搬送装置において、

少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続される搬送アームと、前記2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続

され且つ前記被処理体を保持する被処理体保持部とを備え、

前記被処理体保持部が前記一方の腕状部材における前記他端を中心として前記被処理体の表面と平行に回転すると共に、前記一方の腕状部材が前記一端を中心として前記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として前記表面と平行に回転することを特徴とする搬送装置。

【請求項 25】

前記第 1 及び第 2 の載置台の配列方向に沿って前記被処理体を移動させるべく前記 2 つの腕状部材及び前記被処理体保持部が協働して回転することを特徴とする請求項 24 記載の搬送装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、被処理体を処理する被処理体処理装置、その被処理体処理方法、圧力制御方法、被処理体搬送方法、及び搬送装置に関し、特に、ドライエッチング及びウェットエッチングに代わる COR (Chemical Oxide Removal) 処理や CVD 処理を実行する被処理体処理装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、化学反応を利用した薄膜の形状加工として、エッチングがある。通常、エッチング工程はリソグラフィ工程とセットになっており、リソグラフィ工程ではレジストパターンの形成し、エッチング工程では形成されたレジストパターンのとおりに薄膜を形状加工する。

【0003】

エッチングには、ドライエッチングとウェットエッチングの 2 種類がある。ドライエッチングの中で最も一般的なのが平行平板型反応性イオンエッチングである。この平行平板型反応性イオンエッチングでは、真空処理装置（被処理体処理装置）が備える真空処理室を真空にして、当該真空処理室内に被処理体であるウエハを入れ、その後エッチングガスを真空処理室に導入する。

【0004】

真空処理室内にはウエハを載置する載置台と、この載置台のウエハ載置面に平行に対面した上部電極とが配設されている。載置台に高周波電圧を加えると、エッチングガスはプラズマ化する。このプラズマ中では正・負のイオンや電子などの荷電粒子、エッチング種である中性活性種などがバラバラな状態で存在している。エッチング種がウエハ表面の薄膜に吸着されると、ウエハ表面で化学反応が起こり、生成物はウエハ表面から離脱して真空処理室の外部に排気され、エッチングが進行する。また、条件によってはウエハ表面にエッチング種がスパッタリングされて物理的反応によりエッチングが進行する。

【0005】

この際、高周波電界がウエハ表面に垂直にかかるためエッチング種（ラジカル）もウエハ表面に垂直な方向に運動を行う。したがって、エッチングはウエハ表面に垂直な方向に進み、ウエハ表面上を等方的に進むことはない。すなわち、エッチングはウエハ表面上を横へ広がることはない。このため、ドライエッチングは微細加工に向いている。

【0006】

しかしながら、ドライエッチングでは、レジストパターンとおりの高精度微細加工を行うために、被エッチング材とレジスト材とのエッチング速度の比を大きく取り、結晶欠陥の発生や不純物汚染などによるエッチングダメージに注意しなければならない。

【0007】

一方、ウェットエッチングには、薬液の入ったエッチング槽にウエハを浸すディップ式と、ウエハを回転させながらウエハに薬液をスプレーするスピン式とがある。これらの何れであっても、エッチングは等方的に進行するのでサイドエッチが生じてしまう。このため、ウェットエッチングは微細加工には利用できない。ただし、薄膜を全面的に除去する

10

20

30

40

50

などの工程では現在も利用されている。

【0008】

また、化学反応を利用した薄膜の形成法として、CVD (Chemical Vapor Deposition、化学気相成長) 法がある。CVD法では、2種類以上の反応ガスが気相中、或いはウエハの表面近傍などで反応し、該反応によって生成された生成物がウエハ表面に薄膜として形成される。このとき、ウエハが加熱され、該加熱されたウエハからの熱輻射によって反応ガスへ活性化エネルギーが供給され、上述した反応ガスの反応が励起される。

【0009】

従来、フラットパネルディスプレイを含む集積回路及びその他の電子素子の製造において上述したCVD処理を含む成膜処理、酸化処理、拡散処理、上述した形状加工処理としてのエッチング処理、アニール処理等の各種の処理を行うために、真空処理装置が用いられてきた。真空処理装置は、通常1つ以上のロードロック室と、少なくとも1つのトランスファ室と、1つ以上の処理室とを備えている。このような真空処理装置は、少なくとも2つのタイプが知られている。

【0010】

1つのタイプは、マルチチャンパー型の真空処理装置である。この真空処理装置は、3つ乃至6つの真空処理室としてのプロセスチャンバと、これら各プロセスチャンバに被処理体としての半導体ウエハを搬入・搬出する搬送機構を備えた真空予備室 (ロードロック室) と、各プロセスチャンバ及びロードロック室が周配され、それぞれにゲートバルブを介して気密に連通する複数個の接続口を周壁に有した多角形のトランスファチャンバと、このトランスファチャンバ内に設置された旋回及び伸縮可能な搬送アームとから構成されている (例えば、特許文献1参照)。

【0011】

また、もう1つのタイプは、直列型チャンバを備える真空処理装置である。この真空処理装置は、半導体ウエハをエッチング処理する真空処理室と、この真空処理室との間でウエハの受け渡しを行うための搬送手段としてスカラ型シングルピックタイプ若しくはスカラ型ツインピックタイプの搬送アームを内蔵したロードロック室とを備えている。つまり、真空処理室と搬送アームを内蔵したロードロック室とを1つのモジュールとしている (例えば、特許文献2及び特許文献3参照)。

【0012】

尚、上述したいずれの真空処理装置においても、ロードロック室において真空/大気の切換が行われ、ウエハキャリアにセットされたウエハを搬送するロード及び真空処理室間における円滑なウエハの受け渡しを実現している。

【0013】

エッチング処理の場合、いずれの真空処理装置においても、真空処理室に導入したエッチングガス (反応処理ガス) に高周波電圧を印加することによって反応処理ガスをプラズマ化して、エッチングを行っている。これらドライエッチングは、エッチング種が印加電圧によって追従制御されることで垂直異方性に優れたエッチング加工がなされ、リソグラフィの要求線幅通りのエッチングが可能である。

【0014】

しかし、ウエハ表面に回路パターンを焼き付けるフォトリソグラフィ工程での微細加工技術の開発が進められている中、フォトリソグラフィの光源としてKrFエキシマレーザー (波長=248nm) の紫外線露光するプロセスが実用化され、さらに、より短い波長 (波長=193nm) のArFエキシマレーザーを使用したプロセスも実用化されつつある。さらに、2005年の次世代プロセスにおいては、F2レーザー (波長=157nm) を用いたフォトリソグラフィが70nm以下の微細パターンを形成できる技術として最有力になっている。ところが、耐ドライエッチ性を損なうことなく、150~200nmの膜厚で線幅65nm以下の1:1ラインアンドスペースの微細パターン化を可能とするレジスト材料が開発されておらず、在来レジスト材料によってはアウトガスによるパーティクル汚染という実用上の問題が生じており、異方性ドライエッチによる微細パター

10

20

30

40

50

ン化は限界に近づいている。

【0015】

そこで、ドライエッチング及びウェットエッチングに代わる微細化エッチング処理方法としてC O R (Chemical Oxide Removal) が期待されている。C O R 処理は被処理体の酸化膜にガス分子を化学反応させて生成物を付着させるものであり、その後、ウェハを加熱して生成物を除去することによってリソパターンの線幅よりも細い線幅を得ることができる。また、C O R は緩やかな等方性エッチであり、エッチレート圧力は、ガス濃度、ガス濃度比、処理温度、ガス流量、ガス流量比などのパラメータにより制御され、所定の処理時間以上で処理量が飽和することによってエッチングが終了する（エッチストップ）。このように、飽和のポイントを制御することによって所望のエッチレートを得ることができ

10

【0016】

このようなC O R 処理は、ソース／ドレイン拡散活性化焼鈍と、後に除去され且つポリシリコンゲート領域に置き換えられるタミーゲート領域の直前で発生する金属シリケイド化とを有するタマシゲート・プロセスを使用する、最小厚の多空乏層、金属シリサイド層が形成されたソース／ドレイン接合部及び極低膜抵抗ポリゲートを備えるサブ0.1 μ mの金属酸化物半導体電界効果トランジスタ装置の製造に適している（例えば、特許文献4参照）。

【特許文献1】特開平08-46013号公報

【特許文献2】特開2001-53131号公報

20

【特許文献3】特開2000-150618号公報

【特許文献4】米国特許第6440808号明細書

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0017】

従来のエッチング処理を行う真空処理装置では複数の処理をより効率良く行うことが求められている。また、C O R 処理やC V D 処理を行う真空処理装置に対しても、これらの処理では加熱されたウェハを冷却する処理が必要となるため、特に、複数の処理をより効率良く行うことが求められるが、従来の真空処理装置では、上述のように、ロードロック室において真空／大気の切換を行う一方、当該ロードロック室が搬送アームとウェハを冷却する冷却機構とを備えるため、ロードロック室の容積は必然的に大きくなり、真空／大気の切換に時間を要する。また、ロードロック室内に搬入されたウェハは長時間、真空／大気の切換に起因する空気の対流に晒されるため、該対流によって舞上がったパーティクルが付着するというおそれもある。

30

【0018】

本発明の目的は、複数の処理を効率良く行うことができる被処理体処理装置、その被処理体処理方法、圧力制御方法、被処理体搬送方法、及び搬送装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0019】

上記目的を達成するために、請求項1記載の被処理体処理装置は、被処理体を処理する被処理体処理装置において、連通自在且つ縦列に連結された、前記被処理体を処理する複数の処理室と、前記複数の処理室と連通自在に連結され、前記被処理体を前記複数の処理室のそれぞれとの間で搬出入する搬送機構を備えたロードロック室とを備え、前記複数の処理室のうち少なくとも1つは真空処理室であり、前記ロードロック室は、前記複数の処理室と縦列をなす位置に配置されることを特徴とする。

40

【0020】

上記目的を達成するために、請求項2記載の被処理体処理装置は、被処理体を処理する被処理体処理装置において、連通自在且つ縦列に連結された、前記被処理体にC O R 処理を施すC O R 処理室及び前記被処理体に他の処理を施す少なくとも1つの真空処理室と、前記複数の処理室と連通自在に連結され、前記被処理体を前記複数の処理室のそれぞれと

50

の間で搬出入する搬送機構を備えたロードロック室とを備えることを特徴とする。

【0021】

請求項3記載の被処理体処理装置は、請求項2記載の被処理体処理装置において、前記他の処理を施す少なくとも1つの真空処理室は、前記COR処理室に連結され、前記COR処理が施された被処理体に熱処理を施すための熱処理室であることを特徴とする。

【0022】

請求項4記載の被処理体処理装置は、請求項3記載の被処理体処理装置において、前記COR処理室及び前記熱処理室は、常時に真空状態にあることを特徴とする。

【0023】

請求項5記載の被処理体処理装置は、請求項4記載の被処理体処理装置において、前記ロードロック室は、前記複数の処理室と縦列をなす位置に配置されたことを特徴とする。

【0024】

上記目的を達成するために、請求項6記載の被処理体処理方法は、ロードロック室と、被処理体にCOR処理を施すCOR処理室と、前記COR処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の被処理体処理方法であって、第1の被処理体を前記ロードロック室に搬入する第1のロードロック室搬入ステップと、前記第1の搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第1の真空引きステップと、前記真空引きが終了した後に、前記第1の被処理体を前記COR処理室に搬入する第1のCOR処理室搬入ステップと、前記COR処理を開始するCOR処理開始ステップと、前記COR処理の間に第2の被処理体を前記ロードロック室に搬入する第2のロードロック室搬入ステップと、前記第2の搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第2の真空引きステップと、前記真空引きが終了した後に、前記COR処理が終了してから前記第1の被処理体を前記COR処理室から前記熱処理室に移動させる第1の移動ステップと、前記第2の被処理体を前記ロードロック室から前記COR処理室に移動させる第2の移動ステップと、前記COR処理室で前記COR処理を開始し、前記熱処理室で前記熱処理を開始する同時処理開始ステップと、前記熱処理が終了した後前記熱処理室の前記第1の被処理体を前記ロードロック室に移す第3の移動ステップと、大気搬送モジュール側のゲートを開き、前記ロードロック室内の前記第1の被処理体と前記大気搬送モジュールで待機している第3の被処理体とを入れ換える入換ステップとを有することを特徴とする。

【0025】

上記目的を達成するために、請求項7記載の圧力制御方法は、ロードロック室と、被処理体にCOR処理するCOR処理室と、前記COR処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室と、前記被処理体を前記ロードロック室との間で搬出し搬入する大気搬送モジュールとを少なくとも有する被処理体処理装置の圧力制御方法であって、前記熱処理室を真空引き中に、前記ロードロック室を大気状態にして前記COR処理前の前記被処理体前記大気搬送モジュールから前記ロードロック室に搬入する搬入ステップと、前記熱処理室の真空引きを終了して前記ロードロック室を設定圧力まで真空引きするロードロック室真空引きステップと、前記ロードロック室が前記設定圧力に到達した後、当該ロードロック室の真空引きを終了し、「ロードロック室内圧力>熱処理室内圧力」の条件を満たすように前記熱処理室を真空引きする熱処理室真空引きステップと、前記条件が満たされた後に、前記ロードロック室と前記熱処理室とを連通する第1の連通ステップとを有することを特徴とする。

【0026】

上記目的を達成するために、請求項8記載の圧力制御方法は、被処理体にCOR処理するCOR処理室と、前記COR処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の圧力制御方法であって、前記熱処理室を排気しながら当該熱処理室内の圧力をモニタする圧力モニタステップと、「熱処理室内圧力<COR処理室内圧力」の条件を満たすように前記COR処理室内を排気するCOR処理室排気ステップと、前記条件が満たされた時点で、前記COR処理室の排気を終了して、前記熱処理室と

前記ＣＯＲ処理室とを連通する連通ステップとを有することを特徴とする。

【００２７】

請求項９記載の圧力制御方法は、請求項７記載の圧力制御方法において、前記第１の連通ステップに続いて、前記熱処理室を排気しながら当該熱処理室内の圧力をモニタする第１の圧力モニタステップと、「熱処理室内圧力＜ＣＯＲ処理室内圧力」の条件を満たすようにＣＯＲ処理室内を排気するＣＯＲ処理室排気ステップと、前記条件が満たされた時点で、前記ＣＯＲ処理室の排気を終了して、前記熱処理室と前記ＣＯＲ処理室とを連通する第２の連通ステップとを有することを特徴とする。

【００２８】

請求項１０記載の圧力制御方法は、請求項９記載の圧力制御方法において、前記第２の連通ステップの後に、前記ロードロック室及び前記ＣＯＲ処理室に流体を流入させる流入ステップを有することを特徴とする。

【００２９】

請求項１１記載の圧力制御方法は、請求項１０記載の圧力制御方法において、前記ロードロック室から前記熱処理室への流体の流量及び前記ＣＯＲ処理室から前記熱処理室への流体の流量が等しいことを特徴とする。

【００３０】

請求項１２記載の圧力制御方法は、請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の圧力制御方法において、前記ＣＯＲ処理を施した被処理体を前記ＣＯＲ処理室から搬出した後に、前記熱処理室及び前記ＣＯＲ処理室を排気して前記ＣＯＲ処理室の圧力をＥＳＣ残留電荷除去のための除電圧力にする排気ステップを有することを特徴とする。

【００３１】

上記目的を達成するために、請求項１３記載の被処理体処理装置は、被処理体を処理する被処理体処理装置において、前記被処理体に第１の処理を施す第１の処理室と、該第１の処理室と連通自在に連結され且つ前記被処理体に第２の処理を施す第２の処理室と、前記複数の処理室の間に介在して前記複数の処理室のそれぞれと連通自在に連結されると共に、前記被処理体を前記複数の処理室のそれぞれとの間で搬出入する搬送機構を有するロードロック室とを備えることを特徴とする。

【００３２】

請求項１４記載の被処理体処理装置は、請求項１３記載の被処理体処理装置において、前記第２の処理室は、前記第１の処理が施された被処理体に冷却処理を施すための冷却処理室であることを特徴とする。

【００３３】

請求項１５記載の被処理体処理装置は、請求項１４記載の被処理体処理装置において、前記第１の処理室は常時に真空状態にあり、且つ前記第２の処理室は常時に大気圧状態にあることを特徴とする。

【００３４】

請求項１６記載の被処理体処理装置は、請求項１５記載の被処理体処理装置において、前記ロードロック室は前記第１の処理室及び前記第２の処理室と列をなす位置に配置されたことを特徴とする。

【００３５】

上記目的を達成するために、請求項１７記載の被処理体処理装置の被処理体処理方法は、ロードロック室と、被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記真空処理を受けた被処理体に冷却処理を施す大気処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の被処理体処理方法であって、大気搬送モジュールから被処理体を前記ロードロック室に搬入するロードロック室搬入ステップと、前記ロードロック室搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第１の真空／大気の切換ステップと、前記第１の真空／大気の切換ステップの後に、前記被処理体を前記真空処理室に搬入する真空処理室搬入ステップと、前記真空処理室に搬入された被処理体に前記真空処理を施す真空処理ステップと、前記真空処理が施された被処理体を前記ロードロック室に搬出するロードロック室搬出ステップと、前

記ロードロック室搬出ステップの後に前記ロードロック室を大気開放する第2の真空／大気の切換ステップと、前記ロードロック室から前記被処理体を前記大気処理室に搬出する大気処理室搬出ステップと、前記大気処理室に搬出された被処理体に前記冷却処理を施す大気処理ステップと、前記冷却処理が施された被処理体を前記大気搬送モジュールに搬出する大気搬送モジュール搬出ステップとを有することを特徴とする。

【0036】

上記目的を達成するために、請求項18記載の被処理体搬送方法は、被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室と、前記被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記真空処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置における前記搬送手段による被処理体搬送方法であって、前記被処理体を前記ロードロック室に搬入するロードロック室搬入ステップと、前記ロードロック室搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする真空引きステップと、前記真空引きが終了した後に、前記被処理体を前記真空処理室に搬入する真空処理室搬入ステップと、前記真空処理室搬入ステップの後に、前記真空処理を開始する真空処理開始ステップと、前記真空処理が終了してから前記被処理体を前記真空処理室から前記熱処理室に移動させる第1の移動ステップと、前記熱処理室で前記熱処理を開始する熱処理開始ステップと、前記熱処理が終了した後に前記熱処理室の前記被処理体を前記ロードロック室に移す第2の移動ステップと、大気搬送モジュール側のゲートを開き、前記被処理体を前記大気搬送モジュールに搬出する大気搬送モジュール搬出ステップとを有することを特徴とする。

【0037】

上記目的を達成するために、請求項19記載の被処理体搬送方法は、第1の載置台を有し、該第1の載置台に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室と、第2の載置台を有し、該第2の載置台に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記複数の処理室と連通するように配設され且つ前記被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室と、前記搬送手段を制御する制御装置とを備え、前記搬送手段が前記被処理体を保持すると共に前記複数の処理室内を自在に移動する被処理体保持部を有し、前記被処理体保持部が前記被処理体の有無に関する情報を検知する第1の検知手段を有し、前記第1及び第2の載置台のうち少なくとも1つが、前記被処理体の有無に関する情報を検知する第2の検知手段を有し、前記制御装置が前記検知された情報に基づいて前記被処理体の位置を検出する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、初期位置における前記被処理体の中心及び前記載置台の中心の第1の相対的な位置関係を検出する第1の位置関係検出ステップと、前記検出された第1の相対的な位置関係に基づいて前記被処理体の搬送経路を決定し且つ該決定された搬送経路に沿って前記被処理体を搬送する搬送ステップと、前記載置台へ搬送された前記被処理体の中心及び前記初期位置における前記被処理体の中心の第2の相対的な位置関係を検出する第2の位置関係検出ステップと、前記第1及び第2の相対的な位置関係の差に基づいて前記被処理体の位置を補正する位置補正ステップとを有することを特徴とする。

【0038】

請求項20記載の被処理体搬送方法は、請求項19記載の被処理体搬送方法において、前記位置を補正された被処理体の基準面の位置を所定の位置に合わせるべく前記被処理体保持部が前記被処理体を保持したまま回転する被処理体保持部回転ステップを有することを特徴とする。

【0039】

請求項21記載の被処理体搬送方法は、請求項19又は20記載の被処理体搬送方法において、前記初期位置における前記被処理体の中心は、搬送前の前記ロードロック室における前記被処理体の中心であることを特徴とする。

【0040】

上記目的を達成するために、請求項22記載の被処理体搬送方法は、第1の載置台を有し、該第1の載置台に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室に連通するように連結されると共に、第2の載置台を有し、該第2の載置台に載置された前記被処理体に真空処

理を施す真空処理室に前記熱処理室を介して連通するように連結され、前記被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室を備え、前記搬送手段は、少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続される搬送アームと、前記2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続され且つ前記被処理体を保持する被処理体保持部とを有する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、前記被処理体保持部が前記一方の腕状部材における前記他端を中心として前記被処理体の表面と平行に回転すると共に、前記一方の腕状部材が前記一端を中心として前記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として前記表面と平行に回転する被処理体移動ステップを有することを特徴とする。

【0041】

請求項23記載の被処理体搬送方法は、請求項22記載の被処理体搬送方法において、前記被処理体移動ステップでは、前記第1及び第2の載置台の配列方向に沿って前記被処理体を移動させるべく前記2つの腕状部材及び前記被処理体保持部が協動して回転することと特徴とする。

【0042】

上記目的を達成するために、請求項24記載の搬送装置は、第1の載置台を有し、該第1の載置台に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室に連通するように連結されると共に、第2の載置台を有し、該第2の載置台に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室に前記熱処理室を介して連通するように連結されるロードロック室に配設される搬送装置において、少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続される搬送アームと、前記2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続され且つ前記被処理体を保持する被処理体保持部とを備え、前記被処理体保持部が前記一方の腕状部材における前記他端を中心として前記被処理体の表面と平行に回転すると共に、前記一方の腕状部材が前記一端を中心として前記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として前記表面と平行に回転することと特徴とする。

【0043】

請求項25記載の搬送装置は、請求項24記載の搬送装置において、前記第1及び第2の載置台の配列方向に沿って前記被処理体を移動させるべく前記2つの腕状部材及び前記被処理体保持部が協動して回転することと特徴とする。

【発明の効果】

【0044】

請求項1記載の被処理体処理装置によれば、被処理体を処理する複数の処理室が連通自在に連結され、複数の処理室のうち少なくとも1つは真空処理室であるので、複数の処理室間で被処理体の搬出入の動作を簡易化でき、もって少なくとも1つの真空処理を含む複数の処理を効率良く行うことができる。

【0045】

請求項2記載の被処理体処理装置によれば、被処理体にCOR処理を施すCOR処理室及び被処理体に他の処理を施す少なくとも1つの真空処理室が連通自在に連結されており、ロードロック室がそれらと連通自在に連結されているので、COR処理室及び他の複数の処理室間で被処理体の搬出入の動作を簡易化でき、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

【0046】

請求項3記載の被処理体処理装置によれば、COR処理室に熱処理を施すための熱処理室が連結されているので、COR処理後の熱処理を効率良く行うことができる。

【0047】

請求項4記載の被処理体処理装置によれば、COR処理室及び熱処理室における各処理を常時に真空状態の下で連続して行えるので、COR処理後の被処理体表面に水分が吸着することがなく、COR処理後の被処理体の酸化膜に化学反応が起こるのを避けることができる。

【0048】

10

20

30

40

50

請求項5記載の被処理体処理装置によれば、ロードロック室は複数の真空処理室と縦列をなす位置に配置されているので、被処理体の搬出入の動作をより簡易化でき、もって、COR処理及び熱処理を含む複数の処理をなおより効率良く行うことができる。

【0049】

請求項6記載の被処理体処理方法によれば、COR処理室で被処理体にCOR処理を施すと同時に、既にCOR処理を施された被処理体に熱処理室で熱処理を施すことができ、さらに、COR処理の終了を待つ間にCOR処理を施されていない被処理体を準備しておくので、一連の処理間に無駄な時間が生じることなくCOR処理及び熱処理を効率良く行うことができる。

【0050】

請求項7記載の圧力制御方法によれば、ロードロック室と熱処理室とを連通した後、「ロードロック室内圧力>熱処理室内圧力」の条件を満たすように熱処理室を排気するので、熱処理室内の雰囲気ガロードロック室内に回り込むことを防ぐことができる。

【0051】

請求項8記載の圧力制御方法によれば、熱処理室とCOR処理室とを連通した後も継続して「熱処理室内圧力<COR処理室内圧力」の条件を満たすように熱処理室を排気することにより、熱処理室内の雰囲気ガCOR処理室の内部に回り込むことを防ぐことができる。

【0052】

請求項9記載の圧力制御方法によれば、ロードロック室と熱処理室とを連通した後も「熱処理室内圧力<COR処理室内圧力」の条件を満たすように熱処理室を排気するので、熱処理室内の雰囲気ガロードロック室内に回り込むことを防げるとともに、熱処理室とCOR処理室とを連通した後も継続して熱処理室を排気することにより、熱処理室内の雰囲気ガCOR処理室の内部に回り込むことを防ぐことができる。

【0053】

請求項10記載の圧力制御方法によれば、ロードロック室及びCOR処理室に流体を導入させるので、熱処理室からの排気の際に対流などの発生を防ぐことができる。

【0054】

請求項11記載の圧力制御方法によれば、ロードロック室から熱処理室への流体の流量及びCOR処理室から熱処理室への流体の流量が等しいので、熱処理室の圧力平衡状態の維持を行い、さらに排気の流れる方向を一定とすることができる。

【0055】

請求項12記載の圧力制御方法によれば、COR処理を施した被処理体をCOR処理室から搬出した後に、熱処理室及びCOR処理室を排気してCOR処理室の圧力をESC残留電荷除去のための除電圧力にするので、熱処理室内の雰囲気ガCOR処理室内に回り込むことなくESC除電が可能になる。

【0056】

請求項13記載の被処理体処理装置によれば、被処理体に第1の処理を施す第1の処理室及び被処理体に第2の処理を施す第2の処理室が連通自在に連結されており、さらにロードロック室がそれらの間に介在し且つそれらと連通自在に連結されているので、第1の処理室及び第2の処理室間での被処理体の搬出入の動作を簡易化でき、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

【0057】

請求項14記載の被処理体処理装置によれば、第1の処理室にロードロック室を介して冷却処理を施すための冷却処理室が連結されているので、第1の処理後の冷却処理を効率良く行うことができる。

【0058】

請求項15記載の被処理体処理装置によれば、第2の処理室における冷却処理を常時に大気圧状態で行うので、第2の処理室において真空/大気の切換を実行する必要が無く、冷却処理を短時間で実行することができると共に、真空/大気の切換を実行するロードロ

10

20

30

40

50

ック室は冷却機構を備える必要がないため、その容積を小さくすることができ、もって真空／大気の切換を短時間で実行することができる。その結果、複数の処理をさらに効率良く行うことができる。また、ロードロック室内に搬入されたウエハは長時間、真空／大気の切換に起因する空気の対流に晒されることがないため、該対流によって舞い上がったパーティクルが付着するというおそれもなくすることができる。

【0059】

請求項16記載の被処理体処理装置によれば、ロードロック室は第1の処理室及び第2の処理室と列をなす位置に配置されているので、被処理体の搬出入の動作をより簡易化でき、もって、第1の処理及び第2の処理を含む複数の処理をより効率良く行うことができる。

10

【0060】

請求項17記載の被処理体処理方法によれば、ウエハの真空処理後における第2の真空／大気の切換ステップと大気処理ステップとを分けたので、それぞれのステップに要する時間を短縮することができ、もって、複数の処理を効率良く行うことができると共に、ウエハの真空処理後、ロードロック室搬出ステップ、第2の真空／大気の切換ステップ及び大気処理室搬出ステップを経て、大気処理ステップに到るため、大気処理ステップまでにウエハの冷却が進行し、もって、大気処理ステップにおける冷却処理を効率良く行うことができる。

【0061】

請求項18記載の被処理体搬送方法によれば、搬送手段が、被処理体をロードロック室に搬入し、ロードロック室の真空引きが終了した後に、被処理体を真空処理室に搬入し、真空処理が終了してから被処理体を真空処理室から熱処理室に移動させ、熱処理が終了した後に被処理体をロードロック室に移し、さらに、被処理体を大気搬送モジュールに搬出するので、複数の処理室間での被処理体の搬出入の動作を簡易化でき、もって少なくとも1つの真空処理を含む複数の処理を効率良く行うことができる。

20

【0062】

請求項19記載の被処理体搬送方法によれば、各載置台に関して初期位置における被処理体の中心及び載置台の中心の第1の相対的な位置関係を検出し、該検出された第1の相対的な位置関係に基づいて被処理体の搬送経路を決定し、該決定された搬送経路に沿って被処理体を搬送するので、各載置台への搬送経路を短く設定することができると共に、載置台へ搬送された被処理体の中心及び初期位置における被処理体の中心の第2の相対的な位置関係を検出し、第1及び第2の相対的な位置関係の差に基づいて被処理体の位置を補正するので、被処理体を載置台に対して正確な位置に載置することができ、搬送作業の効率を向上することができ、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

30

【0063】

請求項20記載の被処理体搬送方法によれば、被処理体保持部が被処理体を保持したまま回転するので、載置台に対して被処理体の基準面の位置を所定の位置に容易に合わせることができ、搬送作業の効率をより向上することができる。

【0064】

請求項21記載の被処理体搬送方法によれば、初期位置における被処理体の中心は、搬送時のロードロック室における被処理体の中心であるので、各載置台への搬送経路をさらに短く設定することができる。

40

【0065】

請求項22記載の被処理体搬送方法によれば、熱処理室及び真空処理室に連通するように連結されるロードロック室が有する搬送手段において、搬送アームを構成する、互いに一端同士が回転自在に接続された少なくとも2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続され且つ被処理体を保持する被処理体保持部が、一方の腕状部材における他端を中心として被処理体の表面と平行に回転すると共に、一方の腕状部材が一端を中心として上記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として上記表面と平行に回転するので、被処理体を熱処理室及び真空処理室における任意の位置へ、任意の搬送経路に

50

沿って搬送することができ、搬送作業の効率を向上することができ、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

【0066】

請求項23記載の被処理体搬送方法によれば、第1及び第2の載置台の配列方向に沿って被処理体を移動させるべく2つの腕状部材及び被処理体保持部が協働して回転するので、被処理体の搬送経路を短くすることができ、搬送作業の効率をより向上することができる。

【0067】

請求項24記載の搬送装置によれば、熱処理室及び真空処理室に連通するように連結されるロードロック室に配設されると共に、少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続される搬送アームと、2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続され且つ被処理体を保持する被処理体保持部とを備え、該被処理体保持部が一方の腕状部材における他端を中心として被処理体の表面と平行に回転すると共に、一方の腕状部材が一端を中心として上記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として上記表面と平行に回転するので、被処理体を熱処理室及び真空処理室における任意の位置へ、任意の搬送経路に沿って搬送することができ、搬送作業の効率を向上することができ、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

【0068】

請求項25記載の搬送装置によれば、第1及び第2の載置台の配列方向に沿って被処理体を移動させるべく2つの腕状部材及び被処理体保持部が協働して回転するので、被処理体の搬送経路を短くすることができ、搬送作業の効率をより向上することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0069】

以下、本発明の第1の実施の形態にかかる真空処理装置（被処理体処理装置）について図面を参照しながら説明する。

【0070】

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る真空処理装置の概略構成を示す概略平面図である。図2は、図1の真空処理装置の概略構成を示す側面図である。

【0071】

図1において、真空処理装置100は、半導体ウエハ等の被処理体进行处理する第1の真空処理室10、この第1の真空処理室10と連通自在且つ縦列に連結された、被処理体进行处理する第2の真空処理室30、これらと縦列をなす位置で第2の真空処理室30に連通自在に連結されたロードロック室50、及びロードロック室50に連通自在に連結された大気搬送モジュール（Loader Module）70を備えている。

【0072】

第1の真空処理室10の内部には処理の際に被処理体を載置しておく載置台11及び被処理体の受け渡しをするための被処理体保持器12が配設されている。図2に示すように第1の真空処理室10の外側上部にはN₂ガスを供給するガス供給系13が接続されており、外側下部には排気系圧力制御バルブ14が取り付けられている。また、第1の真空処理室10には室内の圧力を測定するための圧力測定器（図示せず）が取り付けられている。

【0073】

この第1の真空処理室10の側壁には被処理体を搬入搬出するための搬送口（図示せず）が穿設されている。同様に第1の搬送口（図示せず）が第2の真空処理室30にも穿設されている。第1の真空処理室10と第2の真空処理室30とは、それぞれの搬送口が穿設された部分同士を連結ユニット20によって連結されている。この連結ユニット20は、第1の真空処理室10と第2の真空処理室30との間の環境隔離をするためにゲートバルブ21や断熱ユニット22を備えている。

【0074】

第2の真空処理室30には処理の際に被処理体を載置しておく載置台31及び被処理体

の受け渡しをするための被処理体保持器 3 2 が配設されている。図 2 に示すように第 2 の真空処理室 3 0 の外側上部には N₂ ガス等を供給するガス供給系 3 3 が接続されており、外側下部には排気系圧力制御バルブ 3 4 が取り付けられている。また、第 2 の真空処理室 3 0 には室内の圧力を測定するための圧力測定器（図示せず）が取り付けられている。

【0075】

この第 2 の真空処理室 3 0 には上記の第 1 の搬送口の他に第 2 の搬送口（図示せず）が穿設されている。同様に第 1 の搬送口（図示せず）がロードロック室 5 0 にも穿設されている。第 2 の真空処理室 3 0 の第 2 の搬送口とロードロック室 5 0 の第 1 の搬送口とは、それぞれ搬送口が穿設された部分同士を連結ユニット 4 0 によって連結されている。これにより、第 1 の真空処理室 1 0、第 2 の真空処理室 3 0 及びロードロック室 5 0 は縦列に配置される。連結ユニット 4 0 は、第 2 の真空処理室 3 0 とロードロック室 5 0 との間の環境隔離をするためにゲートバルブ 4 1 や断熱ユニット 4 2 を備えている。

【0076】

ロードロック室 5 0 の内部には、被処理体の受け渡しをするために搬送中の被処理体を保持する被処理体保持部 5 1 並びに当該被処理体保持部 5 1 を第 1 の真空処理室 1 0、第 2 の真空処理室 3 0 及び大気搬送モジュール 7 0 に搬送する搬送機構 5 2 が配設されている。被処理体を保持している被処理体保持部 5 1 を搬送機構 5 2 が搬送することにより、被処理体を第 1 の真空処理室 1 0、第 2 の真空処理室 3 0 及び大気搬送モジュール 7 0 の間で搬送し、受け渡しをすることができる。

【0077】

図 2 に示すようにロードロック室 5 0 の外側上部には N₂ ガス等を供給するガス供給系 5 3 が接続されており、外側下部には排気系 8 0 が接続されている。また、ロードロック室 5 0 には室内の圧力を測定するための圧力測定器（図示せず）が取り付けられている。

【0078】

このロードロック室 5 0 には上記の第 1 の搬送口の他に第 2 の搬送口（図示せず）が穿設されている。同様の搬送口（図示せず）が大気搬送モジュール 7 0 にも穿設されている。ロードロック室 5 0 と大気搬送モジュール 7 0 とは、それぞれの搬送口が穿設された部分同士を連結ユニット 6 0 によって連結されている。連結ユニット 6 0 は、ロードロック室 5 0 と大気搬送モジュール 7 0 との間の環境隔離をするためにドアバルブ 6 1 や断熱ユニット 6 2 を備えている。

【0079】

以上、真空処理装置 1 0 0 の構成を説明したが、真空処理室の数は第 1 の真空処理室 1 0 及び第 2 の真空処理室 3 0 の 2 つに限らず 3 つ以上の真空処理室を縦列に連結することもできる。

【0080】

上述した真空処理装置 1 0 0 では、後述する被処理体の搬送シーケンスが実行されるが、被処理体が正常に搬送されないとき、被処理体に不正な処理が施されるのを防止するため、被処理体の搬送シーケンスは直ちに中断される必要がある。従って、真空処理装置 1 0 0 は搬送される被処理体の位置を正確に把握する機能を有することが必要である。そのため、真空処理装置 1 0 0 は下記に示す複数の位置センサを備える。

【0081】

まず、被処理体に直接接触する載置台 3 1（若しくは、被処理体保持器 3 2）、搬送機構 5 2（若しくは、被処理体保持部 5 1）及びロードロック室 5 0 内に備えられた被処理体を一時保持するための載置台（不図示）の各々は位置センサを備え、該位置センサによって被処理体の有無を検知すると共に、第 1 の真空処理室 1 0 内の載置台 1 1 は内蔵する E S C チェックの状態や位置センサによって被処理体の有無を検知する。これら検知された情報から被処理体の位置を検出するソフトウェアを作成することはいわゆる真空処理装置の当業者にとって容易な事項であり、このようなソフトウェアにより、例えば、搬送機構 5 2 等の動作を制御する制御部（不図示）は、真空処理装置 1 0 0 の内部において搬送される被処理体の位置を検出することができる。

10

20

30

40

50

【0082】

さらに、第1の真空処理室10、第2の真空処理室30及びロードロック室50には、被処理体の搬送経路に沿ってドアバルブ21、及び各ゲートバルブ41、61を挟んだ位置の各々に、位置センサユニット90、91、92、93、94及び95が配設される。各位置センサユニットは、被処理体の外縁に指向する3つの位置センサ、例えばレーザセンサからなり、各レーザセンサは上記外縁に向かって放射状に配置されるか、若しくは被処理体の外縁に対応した位置に配置され、被処理体の位置を検出するだけでなく、被処理体の中心位置をも検出する。

【0083】

制御部は、搬送前のロードロック室70における被処理体の中心位置（以下「初期位置」という。）と載置台11、31の中心位置との第1の相対的な位置関係を検出し、該検出された第1の相対的な位置関係に基づいて被処理体の搬送経路を決定し、該決定された搬送経路に沿って被処理体を搬送させ、載置台11、31へ搬送された被処理体の中心位置と初期位置との第2の相対的な位置関係を検出し、第1及び第2の相対的な位置関係の差異に基づいて載置台11、31上における被処理体の位置を補正する。これにより、各載置台への搬送経路を短く設定することができると共に、被処理体を載置台11、31に対して正確な位置に載置することができ、搬送作業の効率を向上することができ、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

【0084】

搬送機構52はスカラ型シングルピクタイプ若しくはスカラ型ツインピクタイプ等の多関節アームを備える搬送アームであり、搬送アーム基部には連結ブリーが配され、該連結ブリーはタイミングベルトを介してアームの関節部に配された支持ブリーに連結され、回転駆動力を支持ブリーに伝達する。また、連結ブリーは別のタイミングベルトを介してアームの回転角を検出するエンコーダが有する回転角ブリーにも接続される。

【0085】

エンコーダは、回転角ブリーの回転開始位置、すなわち、搬送アームの移動開始位置を原点として電気的に保存する一方、上記別のタイミングベルトによって回転駆動される回転角ブリーの回転角を回転角センサによってデジタル信号の形式で検出することによって搬送アームの移動距離を検出し、該検出された移動距離を被処理体の搬送、例えば、被処理体の位置決め等が正確に実行されているか否かの判定に使用するティーチングデータとして出力する。

【0086】

真空処理装置100は、位置センサによって検出された被処理体の位置とエンコーダが出力するティーチングデータとを比較することによって、被処理体の位置決め、特に、載置台11や13において被処理体の位置決めが正確に行われているか否かを判定する。

【0087】

また、搬送機構52としての搬送アームは少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続され、2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端には被処理体保持部51が接続される。そして、被処理体保持部51が一方の腕状部材における他端を中心として被処理体の表面と平行に回転すると共に、一方の腕状部材が一端を中心として上記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として上記表面と平行に回転する。これにより、被処理体を第2の真空処理室30及び第1の真空処理室10における任意の位置へ、任意の搬送経路に沿って搬送することができ、搬送作業の効率を向上することができ、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

【0088】

さらに、上述した2つの腕状部材及び被処理体保持部51が任意の搬送経路、例えば、載置台11、31の配列方向に沿って被処理体を移動させるべく協調して回転する。これにより、さらに被処理体の搬送経路を短くすることができ、作業効率をより向上することができる。

【0089】

また、被処理体保持部51は、載置台11、31上において、被処理体であるウエハのオリエンテーションフラット（基準面）の位置を所定の位置に合わせるべく被処理体を保持したまま回転する。これにより、載置台11、31に対してウエハのオリエンテーションフラットの位置を所定の位置に容易に合わせることができ、作業効率をより向上することができる。

【0090】

次に、真空処理装置100が実行する被処理体処理方法及び該方法における被処理体の搬送シーケンスについて説明する。

【0091】

図3は、図1の真空処理装置100における被処理体の搬送シーケンスの流れの前半を示す図である。図4は、図3に示した搬送シーケンスに続く後半の流れを示す図である。

【0092】

以下の説明では、真空処理装置100は被処理体に従来のエッチング処理（ドライエッチング、ウェットエッチング）を行う代わりにCOR（Chemical Oxide Removal）処理及びPHT（Post Heat Treatment）処理（熱処理）を行うものを例にあげる。COR処理は、被処理体の酸化膜にガス分子を化学反応させて生成物を付着させる処理であり、PHT処理は、COR処理を施された被処理体を加熱して、COR処理の化学反応によって被処理体に生成した生成物を酸化・熱酸化（Thermal Oxidation）させて被処理体から飛ばすように除去する処理である。

【0093】

ここで、下地をなす基板と該基板上に形成された所定の層とを有する被処理体に施されるCOR処理では、上記所定の層におけるゲート領域のポリシリコン層を除去した後に露出するポリシリコン、若しくは酸化物の層（酸化膜）が選択的にエッチングされるが、このCOR処理では当該エッチングの進行が基板の表面で停止するようにエッチレートが制御される。また、このCOR処理には、ゲート開口部を形成するために、HF及びNH₃の蒸気をエッチャント・ガスとして使用することによって低圧で実現可能な気相化学的酸化物除去プロセス（Vaporphase Chemical Oxide Removal Process）が含まれる。

【0094】

以下、第1の真空処理室10は被処理体にCOR処理を行うCOR処理室10とし、第2の真空処理室30は被処理体にPHT処理を行うPHT処理室30とする。ここでCOR処理室10におけるガス供給系13は、シャワーヘッドであるのが好ましく、この場合、COR処理室10内に均一に導入ガスを供給することが可能である。

【0095】

COR処理室10の容積は約30リットルであり、内部の圧力は0.5～3.0mTorrであり、温度は15～50℃であり、導入ガスはF含有の反応性ガス、還元性ガス、不活性ガス等である。不活性ガスはAr、He、Ne、Kr、Xe等のガスであるが、Arガスが好ましい。

【0096】

また、PHT処理室30の容積は約50リットルであり、内部の圧力は搬送時の圧力と異なるプロセス時の圧力に2段減圧される。また、2段減圧に限らず、プロセス条件に応じて2段以上の多段減圧であってもよい。また、内部の温度は80～200℃であり、真空ポンプ排気速度は1600～1800L/min（200mTorr時）であり、プロセス終了時（0.5mTorr時）には0～100L/minであるが、PHT処理室30の真空度が達成されているとき、ポンプは作動しない。PHT処理室30に導入されるガスはパーティクル飛散防止及び冷却のためのガスであり、ダウフローガス（N₂）である。

【0097】

図3の（1）に示すように、始めに、被処理体W1が大気搬送モジュール70にあり、連結ユニット20、40が閉じられており、COR処理室10とPHT処理室30とが隔離されている。一方、連結ユニット60は開かれている。なお、被処理体W1は既に従来から有る処理によって表面に所定のパターンが形成されている。（2）に示すように、1

枚目の被処理体W1を大気搬送モジュール70からロードロック室50に搬入し、連結ユニット60のドアーバルブ61を閉じる。次に、排気系圧力制御バルブ34を閉じてロードロック室50を真空引きする。ロードロック室50の真空引きが終了した後に、(3)に示すように排気系圧力制御バルブ34を開き、連結ユニット40のゲートバルブ41を開く。その後、連結ユニット20のゲートバルブ21を開く。

【0098】

次に、(4)に示すように被処理体保持部51で保持した被処理体W1を搬送機構52によってCOR処理室10に搬入し、(5)に示すように被処理体保持部51及び搬送機構52がロードロック室50に戻った後にゲートバルブ21、41を閉じてCOR処理を開始する。この処理の間に、ロードロック室50を大気開放する。

10

【0099】

次に、(6)及び(7)に示すように2枚目の被処理体W2を大気搬送モジュール70からロードロック室50に搬入し、ドアーバルブ61を閉じるとともに排気系圧力制御バルブ34を閉じてロードロック室50の真空引きを開始する。ロードロック室50の真空引きが終了した後に排気系圧力制御バルブ34及びゲートバルブ41を開けてCOR処理の終了を待つ。

【0100】

(8)及び(9)に示すように、COR処理が終了した後にゲートバルブ21を開き、被処理体W1をCOR処理室10からPHT処理室30に移す。

【0101】

20

次に、(10)及び(11)に示すように、被処理体W2をロードロック室50からCOR処理室10に移し、(12)に示すように、被処理体保持部51及び搬送機構52がロードロック室50に戻った後にゲートバルブ21、41を閉じて、COR処理室10ではCOR処理を開始し、PHT処理室30ではPHT処理を開始する。

【0102】

PHT処理が終了した後は、(13)に示すようにゲートバルブ41を開いてPHT処理室30の被処理体W1をロードロック室50に移す。

【0103】

次に、(14)乃至(16)に示すように、ゲートバルブ41を閉じてロードロック室50を大気開放した後に、ロードロック室50内の被処理体W1と大気搬送モジュール70に待機している3枚目の被処理体W3とを入れ換える。この後、(17)に示すようにロードロック室50を真空引きする。さらに、ゲートバルブ41を開いて被処理体W2に対するCOR処理が終了するまで待機する。上記搬送シーケンスには圧力制御を伴う。以上をロット(Lot)終了まで繰り返す。

30

【0104】

以上説明した搬送シーケンスにおける(1)～(16)の各ステップでは、上述した位置センサによって検出された被処理体の位置とフィードバックデータとの比較に基づいた被処理体の位置決め判定が実行されてもよく、或るステップにおいて被処理体の位置決めが正確に行われていない場合には、被処理体の搬送を中断すると共に、当該ステップと、当該ステップにおける被処理体の位置とを保存し、保存されたデータを再処理レシピの基礎データとして活用してもよい。

40

【0105】

以上の説明は搬送方法の一例であり、例えば、ロードロック室50→第1の真空処理室10→ロードロック室50、ロードロック室50→第2の真空処理室30→ロードロック室50、ロードロック室50→第2の真空処理室30→第1の真空処理室10→ロードロック室50などの搬送パターンも可能である。

【0106】

さらに、必要に応じて第1の真空処理室10←→第2の真空処理室30間の往復も可能である。被処理体を上記のCOR処理室10(第1の真空処理室10)とPHT処理室30(第2の真空処理室30)との間で往復させて、COR処理及びPHT処理を繰り返す

50

ことにより、理論的には被処理体に形成するパターンの線幅をより細くすることができる。従って、パターンの微細化に対応することができる。

【0107】

本発明の第1の実施の形態に係る真空処理装置によれば、搬送機構52が、被処理体W1をロードロック室50に搬入し、ロードロック室50の真空引きが終了した後に、被処理体W1をCOR処理室10搬入し、COR処理が終了してから被処理体W1をCOR処理室10からPHT処理室30に移動させ、PHT処理が終了した後にPHT処理室30の被処理体W1をロードロック室50に移し、さらに、被処理体W1を大気搬送モジュール70に搬出するので、複数の処理室間での被処理体W1の搬入搬送の動作を簡易化でき、もって少なくとも1つのCOR処理を含む複数の処理を効率良く行うことができる。

【0108】

また、本発明の第1の実施の形態に係る真空処理装置によれば、次のプロセス条件を満たす場合には、第1の真空処理室10を待機させることなく、2つの連続した処理を効率よく行うことができる。

【0109】

第1の真空処理室10における処理の時間：第1処理時間

第2の真空処理室30における処理の時間：第2処理時間

ロードロック室50と第2の真空処理室30との間の被処理体の入れ換え時間：第1の入換時間

ロードロック室50と大気搬送モジュール70との間の入換時間：第2の入換時間

プロセス条件：(第1処理時間) \geq (第2処理時間) + (第1の入換時間) + (第2の入換時間) + (ロードロック室50の給排気時間)

第1の真空処理室10及び第2の真空処理室30の構成は、上記の例に限らず、エッチングシステム、成膜システム、コーティングシステム、計測システム、熱処理システムなど必要なモジュールを組み合わせて構成することができる。

【0110】

また、第1の真空処理室10及び第2の真空処理室30が常時真空の場合には、第2の真空処理室30及びロードロック室50を同時に真空引きする場合はないので、第2の真空処理室30及びロードロック室50の排気系80を共用することができる。

【0111】

次に、真空処理装置100の動作中における圧力調整について説明する。

【0112】

図5は、真空処理装置100の圧力調整におけるタイミングチャートを示す図である。

【0113】

1) PHT処理室30を真空引き中に、ロードロック室50を大気状態にしてCOR処理前の被処理体を大気搬送モジュール70からロードロック室50に搬入した後、PHT処理室30に取り付けられている排気系圧力制御バルブ34（以下、PHT排気バルブ34）を閉じ、ロードロック室50の真空引きを開始する。

【0114】

ロードロック室50が設定圧力に到達した後、ロードロック室50の排気バルブ（図示せず。L M排気バルブ）を閉じて、PHT排気バルブ34を開き、

ロードロック室50内圧力 > PHT処理室30内圧力となるように制御し、制御完了を確認後、ロードロック室50 - PHT処理室30間のゲートバルブ41（以下、PHT側ゲートバルブ41）を開いて、ロードロック室50とをPHT処理室30連通させる。

【0115】

PHT側ゲートバルブ41を開いた後も継続してPHT排気バルブ34を開いておき、排気することによってPHT雰囲気ガロードロック室50内に回り込むことを防げる。また、ロードロック室50から積極的に流体（ N_2 ）を流し、対流の発生などを防ぐことも可能である。

【0116】

- 2) PHT処理室30内の圧力をモニタし、
PHT処理室30内圧力<COR処理室10内圧力
となる様にCOR処理室10内の圧力を圧力制御する。

【0117】

PHT処理室30内圧力<COR処理室10内圧力
となった時点で、COR処理室10に取り付けられた排気系圧力制御バルブ14（以下、COR排気バルブ14）を閉じ、PHT処理室30-COR処理室10間ゲートバルブ21（以下、COR側ゲートバルブ21）を開く。

【0118】

COR側ゲートバルブ21を開いた後も継続してPHT排気バルブ34を開いておき、排気することにより、PHT処理室30内の雰囲気圧がCOR処理室10の内部に回り込むことを防ぐことができる。また、COR処理室10から積極的に流体（N₂）を流し、対流の発生などを防ぐことも可能である。

【0119】

3) 1)に記述のシーケンスでPHT側ゲートバルブ41を開き、ロードロック室50とPHT処理室30とを1モジュールと想定して、(2)に記述のシーケンスでCOR側ゲートバルブ21を開く。PHT側ゲートバルブ41、COR側ゲートバルブ21が開いた後も継続してPHT排気バルブ34を開いておき排気することにより、PHT処理室30内の雰囲気圧がロードロック室50の内部、COR処理室10の内部に回り込むことを防ぐことができる。

【0120】

また、積極的にロードロック室50、COR処理室10に流体（N₂）を流入させて、対流などの発生を防ぐことも可能であり、PHT処理室30への流体の流量をロードロック室50からの流量=COR処理室10からの流量とすることによって、逆流が起こらないようにすることも可能である。

【0121】

4) 上述の3)に記述のシーケンスにおいて、COR処理を施した被処理体をCOR処理室10から搬出した後にESC残留電荷除去のため、PHT排気系34を用いてCOR処理室10内を除電圧力になるように制御する。これにより、PHT処理室30内の雰囲気圧がCOR処理室10内に回り込むことなくESC除電が可能になる。

【0122】

また、PHT処理室30及びCOR処理室10における処理を常時に真空状態で連続して行うことができるので、COR後の被処理体の酸化膜が大気的水分を吸収したりして化学反応を起こすことを防止できる。

【0123】

尚、上述した搬送方法では製品となるウエハ（製品ウエハ）が被処理体として搬送されたが、搬送される被処理体は製品ウエハに限られず、真空処理装置100の各処理室やデバイスの作動を検査するためのダミーウエハや、各処理室のシーズニングに使用される他のダミーウエハであってもよい。

【0124】

次に、本発明の第2の実施の形態にかかる真空処理装置について図面を参照しながら説明する。

【0125】

図6は、本発明の第2の実施の形態に係る真空処理装置の概略構成を示す概略平面図である。図7は、図6の真空処理装置の概略構成を示す側面図である。

【0126】

図6において、真空処理装置600は、被処理体に真空処理を施す真空処理室601と、この真空処理室601と連通自在且つ縦列に連結された、被処理体に他の処理を施す大気処理室602と、真空処理室601及び大気処理室602の間に介在し、これらと列を

10

20

30

40

50

なす位置で真空処理室 601 及び大気処理室 602 に連通自在に連結されたロードロック室 603 と、大気処理室 602 に連通自在に連結された大気搬送モジュール 604 とを備えている。

【0127】

真空処理室 601 の内部には、処理の際、真空処理室 601 の内部においてプラズマを発生させるための高周波電圧が印加される下部電極及び被処理体を載置しておくための台座を兼ねる載置台 605 と、該載置台 605 に内蔵され且つ載置台 605 に載置された被処理体を加熱するヒータ 606 と、真空処理室 601 の内部に反応ガスを供給する供給系及び下部電極としての載置台 605 と協働して当該内部に高周波電界を発生させる上部電極を兼ねるシャワーヘッド 607 と、開閉自在なバルブ（図示せず）を有し且つ真空処理室 601 の内部に発生したプラズマや生成物の残滓を排出する排出口 608 と、室内の圧力を測定するための圧力測定器（図示せず）が配設される。真空処理室 601 の内部は常時に真空状態であり、ここでは真空処理が実行可能な状況となっている。

【0128】

この真空処理室 601 の側壁には被処理体を搬入搬出するための搬送口（図示せず）が穿設されている。真空処理室 601 に隣接して配されるロードロック室 603 の側壁にも同様の搬送口（図示せず）が穿設されている。真空処理室 601 とロードロック室 603 とは、それぞれの搬送口が穿設された部分同士を連結ユニット 611 によって連結されている。この連結ユニット 611 は、真空処理室 601 とロードロック室 603 との間の環境隔離をするためにゲートバルブ 612 や断熱ユニット 613 を備えている。

【0129】

大気処理室 602 の内部には、被処理体を載置しておくための載置台 609 と、載置台 609 に載置された被処理体を保持する保持具 610 とが配設される。載置台 609 は、冷媒が循環可能な冷却機構として冷却回路（図示せず）を内蔵し、載置された被処理体を冷却する。また、大気処理室 602 は常時に大気開放され、その内部は大気圧状態にある。従って、大気処理室 602 は CVD 処理等によって加熱された被処理体の冷却処理を大気圧状態において実行可能である。

【0130】

また、大気処理室 602 は冷却機構として、上述した冷却回路の他、冷却のためのダウンフローガス、例えば、 N_2 、 Ar 、 He ガス等の不活性ガス等を内部に導入する導入口を備えていてもよい。

【0131】

この大気処理室 602 の側壁には被処理体を搬入搬出するための搬送口（図示せず）が穿設されている。大気処理室 602 に隣接して配されるロードロック室 603 の側壁にも上述した搬送口とは別に、他の搬送口（図示せず）が同様に穿設されている。大気処理室 602 とロードロック室 603 とは、それぞれ搬送口が穿設された部分同士を連結ユニット 614 によって連結されている。これにより、真空処理室 601、ロードロック室 603 及び大気処理室 602 は順に列をなすように配置される。連結ユニット 614 は、大気処理室 602 とロードロック室 603 との間の環境隔離をするためにゲートバルブ 615 や断熱ユニット 616 を備えている。

【0132】

ロードロック室 603 の内部には、被処理体の受け渡しをするために搬送中の被処理体を保持する被処理体保持部 617、並びに当該被処理体保持部 617 を真空処理室 601 及び大気処理室 602 に搬送する搬送機構 618 が配設されている。被処理体を保持している被処理体保持部 617 を搬送機構 618 が搬送することにより、被処理体を真空処理室 601 及び大気処理室 602 の間で搬送し、受け渡しをすることができる。また、ロードロック室 603 の内部の容積は、搬送機構 618 の作動を阻害しない程度の必要最小限度の空間が確保可能な容積に設定される。

【0133】

図 7 に示すようにロードロック室 603 の外側下部にはロードロック室 603 の内部と

10

20

30

40

50

外部とを連通するパイプ 6 1 9 が配設され、該パイプ 6 1 9 にはターボ分子ポンプなどの真空引き用ポンプ 6 2 3 と、ロードロック室 6 0 3 の内部及び真空引き用ポンプ 6 2 3 の連通・遮断が自在なバルブ 6 2 4 とが配される。また、ロードロック室 6 0 3 には室内の圧力を測定するための圧力測定器（図示せず）が取り付けられている。さらに、ロードロック室 6 0 3 の外側下部には N_2 ガス等を供給するガス供給系 6 2 0 が接続されている。従って、ロードロック室 6 0 3 はパイプ 6 1 9 とガス供給系 6 2 0 によってその内部の真空/大気の切換が可能となる構成となっている。

【0134】

大気搬送モジュール 6 0 4 の内部には、上述した被処理体保持部 6 1 7 及び搬送機構 6 1 8 と同様の被処理体保持部 6 2 5 及び搬送機構 6 2 6 が配設されている。そして、被処理体保持部 6 2 5 及び搬送機構 6 2 6 によって被処理体を大気搬送モジュール 6 0 4 に取り付けられた被処理体のキャリア（図示せず）及び大気処理室 6 0 2 の間で搬送し、受け渡しをすることができる。

【0135】

この大気搬送モジュール 6 0 4 の側壁には搬送口（図示せず）が穿設されている。また、大気搬送モジュール 6 0 4 に隣接して配される大気処理室 6 0 2 の側壁にも上述した搬送口とは別に、他の搬送口（図示せず）が同様に穿設されている。大気搬送モジュール 6 0 4 と大気処理室 6 0 2 とは、それぞれ搬送口が穿設された部分同士を連結ユニット 6 2 7 によって連結されている。

【0136】

以上、真空処理装置 6 0 0 の構成を説明したが、処理室の数は真空処理室 6 0 1 及び大気処理室 6 0 2 の 2 つに限らず 3 つ以上の処理室を縦列に連結することもできることは、本発明の第 1 の実施形態にかかる真空処理装置 1 0 0 と同様である。

【0137】

次に、真空処理装置 6 0 0 が実行する被処理体処理方法及び該方法における被処理体の搬送シーケンスについて説明する。

【0138】

図 8 は、図 6 の真空処理装置 6 0 0 における被処理体の搬送シーケンスの流れを示す図である。

【0139】

以下の説明では、真空処理装置 6 0 0 は被処理体に CVD 処理及び冷却処理を行うものを例にあげる。

【0140】

以下、真空処理室 6 0 1 は CVD 処理室 6 0 1 として被処理体に CVD 処理を行い、大気処理室 6 0 2 は被処理体に大気処理としての冷却処理を行う。尚、図中において連結ユニットの白抜きはゲートバルブの開状態を表し、同黒抜きはゲートバルブの閉状態を表すのは図 3 及び 4 と同じである。

【0141】

まず、図 8 の（１）に示すように、始めに、大気搬送モジュール 6 0 4 にある被処理体 W1 が、大気処理室 6 0 2 に搬入される。このとき、ゲートバルブ 6 1 2 は閉状態にあり、ロードロック室 6 0 3 と CVD 処理室 6 0 1 とが隔離されている。一方、ゲートバルブ 6 1 5 は開状態にあり、大気処理室 6 0 2 とロードロック室 6 0 3 とが連通している。

【0142】

次に、（２）に示すように、被処理体 W1 を大気処理室 6 0 2 からロードロック室 6 0 3 に搬入した後、（３）に示すようにゲートバルブ 6 1 5 を閉状態にし、さらに、パイプ 6 1 9 におけるバルブ 6 2 4 を開き、その後、真空引き用ポンプ 6 2 3 を作動させてロードロック室 6 0 3 を真空引きする。

【0143】

そして、（４）に示すようにゲートバルブ 6 1 2 を開状態にした後、被処理体保持部 6 1 7 で保持した被処理体 W1 を搬送機構 6 1 8 によって CVD 処理室 6 0 1 に搬入し、（

5) に示すように被処理体保持部 6 1 7 及び搬送機構 6 1 8 がロードロック室 6 0 3 に戻った後にゲートバルブ 6 1 2 を閉状態にして CVD 処理室 6 0 1 において被処理体 W 1 に CVD 処理を施す。

【0 1 4 4】

次に、(6) に示すように、CVD 処理が終了した後にゲートバルブ 6 1 2 を開状態にして CVD 処理が施された被処理体 W 1 を CVD 処理室 6 0 1 からロードロック室 6 0 3 に搬出する。

【0 1 4 5】

次に、(7) に示すように、被処理体 W 1 がロードロック室 6 0 3 へ搬出された後、ゲートバルブ 6 1 2 を閉状態にし、さらに、パイプ 6 1 9 におけるバルブ 6 2 4 を閉じ、ガス供給系 6 2 0 からの N₂ ガス等の供給を開始してロードロック室 6 0 3 を大気開放する。ロードロック室 6 0 3 の内部の圧力が大気圧に達した後、(8) に示すように、ゲートバルブ 6 1 5 を開状態にした後、被処理体 W 1 を搬送機構 6 1 8 によって大気処理室 6 0 2 に搬出し、被処理体 W 1 を載置台 6 0 9 に載置し、さらに保持具 6 1 0 によって保持する。

【0 1 4 6】

次に、(9) に示すように、載置台 6 0 9 は被処理体 W 1 を冷却し、被処理体 W 1 が所定温度 (約 7 0℃) まで冷却されると、(10) に示すように、被処理体 W 1 は大気搬送モジュール 6 0 4 へ搬出される。

【0 1 4 7】

そして、真空処理装置 6 0 0 は以上の搬送シーケンスをロット終了まで繰り返す。

【0 1 4 8】

以上説明した搬送シーケンスにおける (1) ~ (10) の各ステップにおいても、本発明の第 1 の実施の形態において説明したように、位置センサによって検出された被処理体の位置とティーチングデータとの比較に基づいた被処理体の位置決め判定が実行されてもよく、或るステップにおいて被処理体の位置決めが正確に行われていない場合には、被処理体の搬送を中断すると共に、当該ステップと、当該ステップにおける被処理体の位置とを保存し、保存されたデータを再処理レシピの基礎データとして活用してもよい。

【0 1 4 9】

また、本第 2 の実施の形態に係る真空処理装置においても、本第 1 の実施の形態において説明したように、位置センサによって検知された情報に基づいて初期位置と載置台 6 0 5、6 0 9 の中心位置との第 1 の相対的な位置関係を検出し、該検出された第 1 の相対的な位置関係に基づいて被処理体の搬送経路を決定し、該決定された搬送経路に沿って被処理体を搬送させ、載置台 6 0 5、6 0 9 へ搬送された被処理体の中心位置と初期位置との第 2 の相対的な位置関係を検出し、第 1 及び第 2 の相対的な位置関係の差異に基づいて載置台 6 0 5、6 0 9 上における被処理体の位置を補正してもよく、これにより、上述した効果と同様の効果を奏することができる。

【0 1 5 0】

また、搬送機構 6 1 8 及び被処理体保持部 6 1 7 は、本第 1 の実施の形態における搬送機構 5 2 及び被処理体保持部 5 1 と同様の構成を有していてもよく、これによっても上述した効果と同様の効果を奏することができる。

【0 1 5 1】

以上の説明は搬送シーケンスの一例であり、他の搬送シーケンスでは、必要に応じて真空処理室 6 0 1 ↔ 大気処理室 6 0 2 間の往復も可能である。被処理体 W 1 を上記の CVD 処理室 6 0 1 (真空処理室 6 0 1) と大気処理室 6 0 2 との間で往復させて、CVD 処理及び冷却処理を繰り返すことにより、被処理体 W 1 の表面に形成される薄膜の厚さのばらつきを抑えることができる。

【0 1 5 2】

また、真空処理室 6 0 1 及び大気処理室 6 0 2 の構成は、上記の例に限らず、エッチングシステム、成膜システム、塗布現像システム、計測システム、熱処理システムなどに

じて必要なモジュールを組み合わせて構成することができる。

【0153】

本発明の第2の実施の形態に係る真空処理装置によれば、被処理体W1にCVD処理を施すCVD処理室601及び被処理体W1に冷却処理を施す大気処理室602が連通自在に連結されており、ロードロック室603はCVD処理室601及び大気処理室602の間に介在し、これらの処理室と列をなす位置に配置されて互いに連通自在に連結されているので、CVD処理室601及び大気処理室602間における被処理体W1の搬入搬送の動作を簡易化でき、もって、CVD処理及び冷却処理を含む複数の処理を効率良く行うことができ、特に、被処理体W1のCVD処理後の冷却処理を効率良く行うことができる。

【0154】

また、大気処理室602における冷却処理を常時に大気圧状態で行うので、大気処理室602において真空/大気の切換を実行する必要が無く、冷却処理を短時間で実行することができると共に、真空/大気の切換を実行するロードロック室603は冷却機構を備える必要がないため、その容積を小さくすることができ、もって真空/大気の切換を短時間で実行することができる。その結果、被処理体W1の冷却処理及び真空/大気の切換を含む複数の処理をさらに効率良く行うことができる。

【0155】

例えば、従来の真空処理装置のように、真空/大気の切換及び冷却処理を同時に実行する場合、ロードロック室が搬送機構だけでなく、冷却機構を備える必要があるため、ロードロック室の容積が大きくなり、真空/大気の切換及び冷却処理に約126秒を要したが、
20
上述した本発明の第2の実施の形態に係る真空処理装置によれば、真空/大気の切換及び冷却処理を夫々異なる処理室で実行する場合、ロードロック室が真空/大気の切換のみを実行し、且つ大気処理室が冷却処理のみを実行すればよく、ロードロック室の容積が小さくなり、真空/大気の切換に約20秒を要するのみであり、且つ冷却処理に約15秒を要するのみなので、真空/大気の切換及び冷却処理に約35秒を要するのみである。

【0156】

さらに、ロードロック室603内に搬入された被処理体W1は長時間、真空/大気の切換に起因する空気の対流に晒されることがないため、該対流によって舞い上がったパーティクルが付着するというおそれもなくすることができる。

【0157】

また、本発明の第2の実施の形態に係る被処理体処理方法によれば、被処理体W1のCVD処理後における真空/大気の切換及び冷却処理をロードロック室603及び大気処理室602の夫々に振り分けたので、夫々の処理に要する時間を短縮することができ、もって、真空/大気の切換及び冷却処理を含む複数の処理を効率良く行うことができると共に、被処理体W1のCVD処理後、ロードロック室603への搬出処理、ロードロック室603での真空/大気の切換処理及び大気処理室602への搬出処理を経て大気処理室602での冷却処理が実行されるため、冷却処理までに被処理体W1の冷却が進行し、例えば、CVD処理直後における被処理体W1の温度が約650℃である場合、大気処理室602への搬出処理後における被処理体W1の温度は約400℃となる。その結果、大気処理室602での被処理体W1の冷却処理を効率良く行うことができる。
40

【0158】

尚、上述した本第2の実施の形態に係る真空処理装置では、被処理体にCVD処理を施したが、当該真空処理装置が被処理体に施す真空処理はこれに限られず、熱処理を伴う真空処理であれば、どのような真空処理でも施すことができ、この場合においても上述した効果を奏することができることは言うまでもない。

【図面の簡単な説明】

【0159】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る真空処理装置の概略構成を示す概略平面図である。

【図2】図1の真空処理装置の概略構成を示す側面図である。

10

30

40

50

【図3】図1の真空処理装置100における被処理体の搬送シーケンスの流れの前半を示す図である。

【図4】図3に示した搬送シーケンスに続く後半の流れを示す図である。

【図5】真空処理装置100の圧力調整におけるタイミングチャートを示す図である。

【図6】本発明の第2の実施の形態に係る真空処理装置の概略構成を示す概略平面図である。

【図7】図6の真空処理装置の概略構成を示す側面図である。

【図8】図6の真空処理装置600における被処理体の搬送シーケンスの流れを示す図である。

【符号の説明】

10

【0160】

10 第1の真空処理室（COR処理装置）

12, 32 被処理体保持器

13, 33, 53 ガス供給系

14, 34 排気系圧力制御バルブ

20, 40, 60, 611, 614, 627 連結ユニット

21, 41, 612, 615 ゲートバルブ

22, 613, 616 断熱ユニット

30 第2の真空処理室（熱処理室）

50, 603 ロードロック室

20

51, 617 被処理体保持部

52, 618, 626 搬送機構

61 ドアバルブ

70, 604 大気搬送モジュール

80 排気系

90, 91, 92, 93, 94, 95 位置センサユニット

100, 600 真空処理装置

601 真空処理室（CVD処理室）

602 大気処理室

605, 609 載置台

30

606 ヒータ

607 シャワーヘッド

608 排出口

610 保持具

619 パイプ

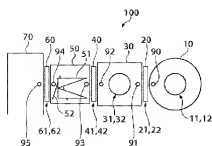
620 ガス供給系

623 真空引き用ポンプ

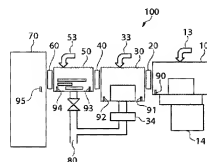
624 バルブ

W1, W2, W3 被処理体

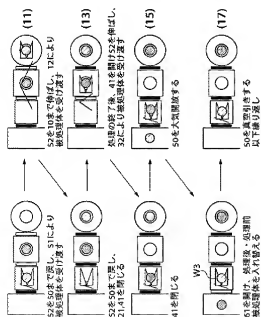
【図 1】



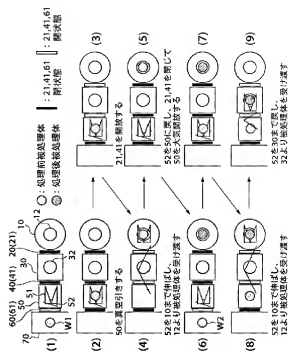
【図 2】



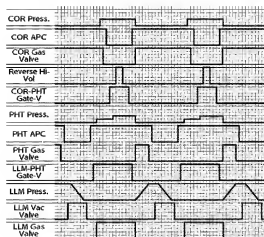
【図 4】



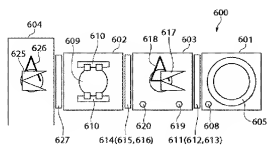
【図 3】



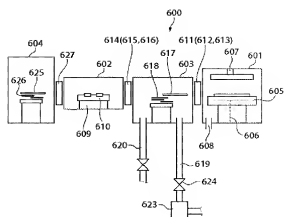
【図 5】



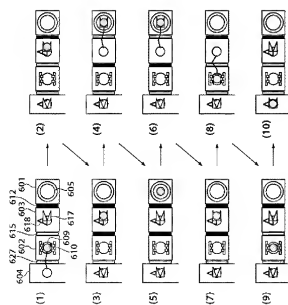
【図 6】



【図 7】



【図 8】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5F031 CA02 GA35 GA43 JA01 JA06 JA17 JA22 JA29 JA32 KA11
KA13 LA13 MA21 MA28 NA04 NA05 NA07 PA02

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年2月1日(2007.2.1)

【公開番号】特開2005-39185(P2005-39185A)

【公開日】平成17年2月10日(2005.2.10)

【年通号数】公開・登録公報2005-006

【出願番号】特願2003-422821(P2003-422821)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

B 6 5 G 49/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 A

B 6 5 G 49/00 A

H 0 1 L 21/302 1 0 1 G

C 2 3 C 16/44 F

【手続補正書】

【提出日】平成18年12月8日(2006.12.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被処理体を処理する被処理体処理装置において、
連通自在且つ隣接して連結された、前記被処理体を処理する第1及び第2の処理室と、
前記第2の処理室と連通自在且つ隣接して連結され、前記被処理体を前記第1及び第2
の処理室のそれぞれの間で搬出入する搬送アーム並びに前記被処理体を保持する被処理体
保持部を備えた1つのロードロック室とを備え、

前記第2の処理室は真空処理室であり、前記1つのロードロック室は前記第1及び第2
の処理室と縦列をなす位置に配置されることを特徴とする被処理体処理装置。

【請求項2】

被処理体を処理する被処理体処理装置において、
連通自在且つ隣接して連結された、前記被処理体にC O R処理を施すC O R処理室及び
前記被処理体に他の処理を施す真空処理室と、

前記真空処理室と連通自在且つ隣接して連結され、前記被処理体を前記C O R処理室及
び前記真空処理室のそれぞれの間で搬出入する搬送アーム並びに前記被処理体を保持する
被処理体保持部を備えた1つのロードロック室とを備えることを特徴とする被処理体処理
装置。

【請求項3】

前記真空処理室は、前記C O R処理が施された被処理体に熱処理を施すための熱処理で
あることを特徴とする請求項2記載の被処理体処理装置。

【請求項4】

前記C O R処理室及び前記熱処理室は、常時に真空状態にあることを特徴とする請求項
3記載の被処理体処理装置。

【請求項5】

前記1つのロードロック室は、前記C O R処理室及び前記真空処理室と縦列をなす位置に配置されたことを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載の被処理体処理装置。

【請求項6】

ロードロック室と、被処理体にC O R処理を施すC O R処理室と、前記C O R処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の被処理体処理方法であって、

第1の被処理体を前記ロードロック室に搬入する第1のロードロック室搬入ステップと、

前記第1の搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第1の真空引きステップと、

前記真空引きが終了した後に、前記第1の被処理体を前記C O R処理室に搬入する第1のC O R処理室搬入ステップと、

前記C O R処理を開始するC O R処理開始ステップと、

前記C O R処理の間に第2の被処理体を前記ロードロック室に搬入する第2のロードロック室搬入ステップと、

前記第2の搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第2の真空引きステップと、

前記真空引きが終了した後に、前記C O R処理が終了してから前記第1の被処理体を前記C O R処理室から前記熱処理室に移動させる第1の移動ステップと、

前記第2の被処理体を前記ロードロック室から前記C O R処理室に移動させる第2の移動ステップと、

前記C O R処理室で前記C O R処理を開始し、前記熱処理室で前記熱処理を開始する同時処理開始ステップと、

前記熱処理が終了した後に前記熱処理室の前記第1の被処理体を前記ロードロック室に移す第3の移動ステップと、

大気搬送モジュール側のゲートを開き、前記ロードロック室内の前記第1の被処理体と前記大気搬送モジュールで待機している第3の被処理体とを入れ換える入換ステップとを有することを特徴とする被処理体処理方法。

【請求項7】

ロードロック室と、被処理体にC O R処理するC O R処理室と、前記C O R処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室と、前記被処理体を前記ロードロック室との間で搬出し搬入する大気搬送モジュールとを少なくとも有する被処理体処理装置の圧力制御方法であって、

前記熱処理室を真空引き中に、前記ロードロック室を大気状態にして前記C O R処理前の前記被処理体を前記大気搬送モジュールから前記ロードロック室に搬入する搬入ステップと、

前記熱処理室の真空引きを終了して前記ロードロック室を設定圧力まで真空引きするロードロック室真空引きステップと、

前記ロードロック室が前記設定圧力に到達した後、当該ロードロック室の真空引きを終了し、

ロードロック室内圧力>熱処理室内圧力

の条件を満たすように前記熱処理室を真空引きする熱処理室真空引きステップと、

前記条件が満たされた後に、前記ロードロック室と前記熱処理室とを連通する第1の連通ステップとを有することを特徴とする圧力制御方法。

【請求項8】

被処理体にC O R処理するC O R処理室と、前記C O R処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の圧力制御方法であって、

前記熱処理室を排気しながら当該熱処理室内の圧力をモニタする圧力モニタステップと、

熱処理室内圧力<COR処理室内圧力

の条件を満たすように前記COR処理室内を排気するCOR処理室排気ステップと、前記条件が満たされた時点で、前記COR処理室の排気を終了して、前記熱処理室と前記COR処理室とを連通する連通ステップとを有することを特徴とする圧力制御方法。

【請求項9】

前記第1の連通ステップに続いて、前記熱処理室を排気しながら当該熱処理室内の圧力をモニタする第1の圧力モニタステップと、

熱処理室内圧力<COR処理室内圧力

の条件を満たすようにCOR処理室内を排気するCOR処理室排気ステップと、前記条件が満たされた時点で、前記COR処理室の排気を終了して、前記熱処理室と前記COR処理室とを連通する第2の連通ステップとを有することを特徴とする請求項7記載の圧力制御方法。

【請求項10】

前記第2の連通ステップの後に、前記ロードロック室及び前記COR処理室に流体を流入させる流入ステップを有することを特徴とする請求項9記載の圧力制御方法。

【請求項11】

前記ロードロック室から前記熱処理室への流体の流量及び前記COR処理室から前記熱処理室への流体の流量が等しいことを特徴とする請求項10記載の圧力制御方法。

【請求項12】

前記COR処理を施した被処理体を前記COR処理室から搬出した後に、前記熱処理室及び前記COR処理室を排気して前記COR処理室の圧力をESC残留電荷除去のための除電圧力にする排気ステップを有することを特徴とする請求項9乃至11のいずれか1項に記載の圧力制御方法。

【請求項13】

被処理体を処理する被処理体処理装置において、前記被処理体に第1の処理を施す第1の処理室と、該第1の処理室と連通自在に連結され且つ前記被処理体に第2の処理を施す第2の処理室と、

前記複数の処理室の間に介在して前記複数の処理室のそれぞれと連通自在に連結されると共に、前記被処理体を前記複数の処理室のそれぞれとの間で搬出入する搬送機構を有するロードロック室とを備えることを特徴とする被処理体処理装置。

【請求項14】

前記第2の処理室は、前記第1の処理が施された被処理体に冷却処理を施すための冷却処理室であることを特徴とする請求項13記載の被処理体処理装置。

【請求項15】

前記第1の処理室は常時に真空状態にあり、且つ前記第2の処理室は常時に大気圧状態にあることを特徴とする請求項14記載の被処理体処理装置。

【請求項16】

前記ロードロック室は前記第1の処理室及び前記第2の処理室と列をなす位置に配置されたことを特徴とする請求項15記載の被処理体処理装置。

【請求項17】

ロードロック室と、被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記真空処理が施された被処理体に冷却処理を施す大気処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の被処理体処理方法であって、

大気搬送モジュールから被処理体を前記ロードロック室に搬入するロードロック室搬入ステップと、

前記ロードロック室搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第1の真空／大気の切替ステップと、

前記第1の真空／大気の切替ステップの後に、前記被処理体を前記真空処理室に搬入する真空処理室搬入ステップと、

前記真空処理室に搬入された被処理体に前記真空処理を施す真空処理ステップと、
 前記真空処理が施された被処理体を前記ロードロック室に搬出するロードロック室搬出ステップと、
 前記ロードロック室搬出ステップの後に前記ロードロック室を大気開放する第2の真空／大気の切替ステップと、
 前記ロードロック室から前記被処理体を前記大気処理室に搬出する大気処理室搬出ステップと、
 前記大気処理室に搬出された被処理体に前記冷却処理を施す大気処理ステップと、
 前記冷却処理が施された被処理体を前記大気搬送モジュールに搬出する大気搬送モジュール搬出ステップとを有することを特徴とする被処理体処理方法。

【請求項18】

被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室と、前記被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記真空処理を受けた被処理体に熱処理を施す熱処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、
 前記被処理体を前記ロードロック室に搬入するロードロック室搬入ステップと、
 前記ロードロック室搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする真空引きステップと、
 前記真空引きが終了した後に、前記被処理体を前記真空処理室に搬入する真空処理室搬入ステップと、
 前記真空処理室搬入ステップの後に、前記真空処理を開始する真空処理開始ステップと、

前記真空処理が終了してから前記被処理体を前記真空処理室から前記熱処理室に移動させる第1の移動ステップと、
 前記熱処理室で前記熱処理を開始する熱処理開始ステップと、
 前記熱処理が終了した後に前記熱処理室の前記被処理体を前記ロードロック室に移す第2の移動ステップと、
 大気搬送モジュール側のゲートを開き、前記被処理体を前記大気搬送モジュールに搬出する大気搬送モジュール搬出ステップとを有することを特徴とする被処理体搬送方法。

【請求項19】

第1の載置台を有し、該第1の載置台に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室と、第2の載置台を有し、該第2の載置台に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記複数の処理室と連通するように配設され且つ前記被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室と、前記搬送手段を制御する制御装置とを備え、前記搬送手段が前記被処理体を保持すると共に前記複数の処理室内を自在に移動する被処理体保持部を有し、前記被処理体保持部が前記被処理体の有無に関する情報を検知する第1の検知手段を有し、前記第1及び第2の載置台のうち少なくとも1つが、前記被処理体の有無に関する情報を検知する第2の検知手段を有し、前記制御装置が前記検知された情報に基づいて前記被処理体の位置を検出する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、

初期位置における前記被処理体の中心及び前記載置台の中心の第1の相対的な位置関係を検出する第1の位置関係検出ステップと、
 前記検出された第1の相対的な位置関係に基づいて前記被処理体の搬送経路を決定し且つ該決定された搬送経路に沿って前記被処理体を搬送する搬送ステップと、
 前記載置台へ搬送された前記被処理体の中心及び前記初期位置における前記被処理体の中心の第2の相対的な位置関係を検出する第2の位置関係検出ステップと、
 前記第1及び第2の相対的な位置関係の差に基づいて前記被処理体の位置を補正する位置補正ステップとを有することを特徴とする被処理体搬送方法。

【請求項20】

前記位置を補正された被処理体の基準面の位置を所定の位置に合わせるべく前記被処理体保持部が前記被処理体を保持したまま回転する被処理体保持部回転ステップを有するこ

とを特徴とする請求項19記載の被処理体搬送方法。

【請求項21】

前記初期位置における前記被処理体の中心は、搬送前の前記ロードロック室における前記被処理体の中心であることを特徴とする請求項19又は20記載の被処理体搬送方法。

【請求項22】

第1の載置台を有し、該第1の載置台に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室に連通するように連結されると共に、第2の載置台を有し、該第2の載置台に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室に前記熱処理室を介して連通するように連結され、前記被処理体を搬送する搬送手段を有するロードロック室を備え、前記搬送手段は、少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続される搬送アームと、前記2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続され且つ前記被処理体を保持する被処理体保持部とを有する被処理体処理装置における前記搬送手段の被処理体搬送方法であって、

前記被処理体保持部が前記一方の腕状部材における前記他端を中心として前記被処理体の表面と平行に回転すると共に、前記一方の腕状部材が前記一端を中心として前記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として前記表面と平行に回転する被処理体移動ステップを有することを特徴とする被処理体搬送方法。

【請求項23】

前記被処理体移動ステップでは、前記第1及び第2の載置台の配列方向に沿って前記被処理体を移動させるべく前記2つの腕状部材及び前記被処理体保持部が協動して回転することを特徴とする請求項22記載の被処理体搬送方法。

【請求項24】

第1の載置台を有し、該第1の載置台に載置された被処理体に熱処理を施す熱処理室に連通するように連結されると共に、第2の載置台を有し、該第2の載置台に載置された前記被処理体に真空処理を施す真空処理室に前記熱処理室を介して連通するように連結されるロードロック室に配設される搬送装置において、

少なくとも2つの腕状部材からなり、該2つの腕状部材は互いに一端同士が回転自在に接続される搬送アームと、前記2つの腕状部材のうち一方の腕状部材における他端に接続され且つ前記被処理体を保持する被処理体保持部とを備え、

前記被処理体保持部が前記一方の腕状部材における前記他端を中心として前記被処理体の表面と平行に回転すると共に、前記一方の腕状部材が前記一端を中心として前記表面と平行に回転し且つ他の腕状部材が他端を中心として前記表面と平行に回転することを特徴とする搬送装置。

【請求項25】

前記第1及び第2の載置台の配列方向に沿って前記被処理体を移動させるべく前記2つの腕状部材及び前記被処理体保持部が協動して回転することを特徴とする請求項24記載の搬送装置。

【請求項26】

前記搬送アームは、前記第2の処理室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記第1の処理室へ搬入することを特徴とする請求項1記載の被処理体処理装置。

【請求項27】

前記搬送アームは、前記1つのロードロック室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記第1の処理室から前記第2の処理室へ搬送することを特徴とする請求項1記載の被処理体処理装置。

【請求項28】

前記搬送アームは、前記真空処理室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記C O R処理室へ搬入することを特徴とする請求項2記載の被処理体処理装置。

【請求項29】

前記搬送アームは、前記1つのロードロック室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記C O R処理室から前記真空処理室へ搬送することを特徴とする請求項2

記載の被処理体処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

上記目的を達成するために、請求項1記載の被処理体処理装置は、被処理体を処理する被処理体処理装置において、連通自在且つ隣接して連結された、前記被処理体を処理する第1及び第2の処理室と、前記第2の処理室と連通自在且つ隣接して連結され、前記被処理体を前記第1及び第2の処理室のそれぞれの間で搬出入する搬送アーム並びに前記被処理体を保持する被処理体保持部を備えた1つのロードロック室とを備え、前記第2の処理室は真空処理室であり、前記1つのロードロック室は前記第1及び第2の処理室と縦列をなす位置に配置されることを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

上記目的を達成するために、請求項2記載の被処理体処理装置は、被処理体を処理する被処理体処理装置において、連通自在且つ隣接して連結された、前記被処理体にC O R処理を施すC O R処理室及び前記被処理体に他の処理を施す真空処理室と、前記真空処理室と連通自在且つ隣接して連結され、前記被処理体を前記C O R処理室及び前記真空処理室のそれぞれの間で搬出入する搬送アーム並びに前記被処理体を保持する被処理体保持部を備えた1つのロードロック室とを備えることを特徴とする。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

請求項3記載の被処理体処理装置は、請求項2記載の被処理体処理装置において、前記真空処理室は、前記C O R処理が施された被処理体に熱処理を施すための熱処理室であることを特徴とする。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

請求項5記載の被処理体処理装置は、請求項2乃至4のいずれか1項に記載の被処理体処理装置において、前記1つのロードロック室は、前記C O R処理室及び前記真空処理室と縦列をなす位置に配置されたことを特徴とする。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0035

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0035】

上記目的を達成するために、請求項 17 記載の被処理体処理装置の被処理体処理方法は、ロードロック室と、被処理体に真空処理を施す真空処理室と、前記真空処理が施された被処理体に冷却処理を施す大気処理室とを少なくとも有する被処理体処理装置の被処理体処理方法であって、大気搬送モジュールから被処理体を前記ロードロック室に搬入するロードロック室搬入ステップと、前記ロードロック室搬入ステップの後に前記ロードロック室を真空引きする第 1 の真空／大気の切換ステップと、前記第 1 の真空／大気の切換ステップの後に、前記被処理体を前記真空処理室に搬入する真空処理室搬入ステップと、前記真空処理室に搬入された被処理体に前記真空処理を施す真空処理ステップと、前記真空処理が施された被処理体を前記ロードロック室に搬出するロードロック室搬出ステップと、前記ロードロック室搬出ステップの後に前記ロードロック室を大気開放する第 2 の真空／大気の切換ステップと、前記ロードロック室から前記被処理体を前記大気処理室に搬出する大気処理室搬出ステップと、前記大気処理室に搬出された被処理体に前記冷却処理を施す大気処理ステップと、前記冷却処理が施された被処理体を前記大気搬送モジュールに搬出する大気搬送モジュール搬出ステップとを有することを特徴とする。

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0043】

請求項 25 記載の搬送装置は、請求項 24 記載の搬送装置において、前記第 1 及び第 2 の載置台の配列方向に沿って前記被処理体を移動させるべく前記 2 つの腕状部材及び前記被処理体保持部が協働して回転することを特徴とする。

請求項 26 記載の被処理体処理装置は、請求項 1 記載の被処理体処理装置において、前記搬送アームは、前記第 2 の処理室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記第 1 の処理室へ搬入することを特徴とする。

請求項 27 記載の被処理体処理装置は、請求項 1 記載の被処理体処理装置において、前記搬送アームは、前記 1 つのロードロック室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記第 1 の処理室から前記第 2 の処理室へ搬送することを特徴とする。

請求項 28 記載の被処理体処理装置は、請求項 2 記載の被処理体処理装置において、前記搬送アームは、前記真空処理室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記 C O R 処理室へ搬入することを特徴とする。

請求項 29 記載の被処理体処理装置は、請求項 2 記載の被処理体処理装置において、前記搬送アームは、前記 1 つのロードロック室が前記被処理体を収容している間に、他の被処理体を前記 C O R 処理室から前記真空処理室へ搬送することを特徴とする。

【手続補正 8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0044

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0044】

請求項 1 記載の被処理体処理装置によれば、被処理体を処理する第 1 及び第 2 の処理室が連通自在且つ隣接して連結され、第 2 の処理室は真空処理室であり、第 1 及び第 2 の処理室のそれぞれの間で搬出入する搬送アーム並びに被処理体を保持する被処理体保持部を備えたロードロック室が、第 2 の処理室と連通自在且つ隣接して連結されているので、第 1 及び第 2 の処理室間で被処理体の搬出入の動作を簡易化でき、もって真空処理を含む複数の処理を効率良く行うことができる。

【手続補正 9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0045】

請求項2記載の被処理体処理装置によれば、被処理体にCOR処理を施すCOR処理室及び被処理体に他の処理を施す真空処理室が連通自在且つ隣接して連結され、COR処理室及び真空処理室のそれぞれの間で搬送アーム並びに被処理体を保持する被処理体保持部を備えたロードロック室が、真空処理室と連通自在且つ隣接して連結されているので、COR処理室及び真空処理室間での被処理体の搬出入の動作を簡易化でき、もって複数の処理を効率良く行うことができる。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0046】

請求項3記載の被処理体処理装置によれば、真空処理室はCOR処理が施された被処理体に熱処理を施すための熱処理室であり、該熱処理室はCOR処理室と連通自在且つ隣接して連結されているので、COR処理後の熱処理を効率良く行うことができる。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0048】

請求項5記載の被処理体処理装置によれば、1つのロードロック室はCOR処理室及び真空処理室と縦列をなす位置に配置されているので、被処理体の搬出入の動作をより簡易化でき、もって、COR処理及び熱処理を含む複数の処理をなおより効率良く行うことができる。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0068

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0068】

請求項25記載の搬送装置によれば、第1及び第2の載置台の配列方向に沿って被処理体を移動させるべく2つの腕状部材及び被処理体保持部が協動して回転するので、被処理体の搬送経路を短くすることができ、搬送作業の効率をより向上させることができる。

請求項26記載の被処理体処理装置によれば、搬送アームは、第2の処理室が被処理体を収容している間に、他の被処理体を第1の処理室へ搬入するので、一連の処理間に無駄な時間が生じることなく、複数の処理を効率良く行うことができる。

請求項27記載の被処理体処理装置によれば、搬送アームは、1つのロードロック室が被処理体を収容している間に、他の被処理体を第1の処理室から第2の処理室へ搬送するので、一連の処理間に無駄な時間が生じることなく、複数の処理を効率良く行うことができる。

請求項28記載の被処理体処理装置によれば、搬送アームは、真空処理室が被処理体を収容している間に、他の被処理体をCOR処理室へ搬入するので、一連の処理間に無駄な時間が生じることなく、複数の処理を効率良く行うことができる。

請求項29記載の被処理体処理装置によれば、搬送アームは、1つのロードロック室が被処理体を収容している間に、他の被処理体をCOR処理室から真空処理室へ搬送するので、一連の処理間に無駄な時間が生じることなく、複数の処理を効率良く行うことができ

る。

【手続補正 13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0071】

図1において、真空処理装置100は、半導体ウエハ等の被処理体を処理する第1の真空処理室10（第1の処理室）、この第1の真空処理室10と連通自在且つ隣接して連結された、被処理体を処理する第2の真空処理室30（第2の処理室）、これらと縦列をなす位置で第2の真空処理室30に連通自在に連結されたロードロック室50、及びロードロック室50に連通自在に連結された大気搬送モジュール（Loader Module）70を備えている。

【手続補正 14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0076

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0076】

ロードロック室50の内部には、被処理体の受け渡しをするために搬送中の被処理体を保持する被処理体保持部51並びに当該被処理体保持部51を第1の真空処理室10、第2の真空処理室30及び大気搬送モジュール70に搬送する搬送機構52（搬送アーム）が配設されている。被処理体を保持している被処理体保持部51を搬送機構52が搬送することにより、被処理体を第1の真空処理室10、第2の真空処理室30及び大気搬送モジュール70の間で搬送し、受け渡しをすることができる。

【手続補正 15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0082

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0082】

さらに、第1の真空処理室10、第2の真空処理室30及びロードロック室50には、被処理体の搬送経路に沿って各ゲートバルブ21、41及びドアバルブ61を挟んだ位置の各々に、位置センサユニット90、91、92、93、94及び95が配設される。各位置センサユニットは、被処理体の外縁に指向する3つの位置センサ、例えばレーザセンサからなり、各レーザセンサは上記外縁に向かって放射状に配置されるか、若しくは被処理体の外縁に対応した位置に配置され、被処理体の位置を検出するだけでなく、被処理体の中心位置をも検出する。

【手続補正 16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0097

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0097】

図3の（1）に示すように、始めに、被処理体W1が大気搬送モジュール70にあり、連結ユニット20、40のそれぞれのゲートバルブ21、41が閉じられており、COR処理室10とPHT処理室30とが隔離されている。一方、連結ユニット60のドアバルブ61は開かれている。なお、被処理体W1は既に従来から有る処理によって表面に所定のパターンが形成されている。（2）に示すように、1枚目の被処理体W1を大気搬送モジュール70からロードロック室50に搬入し、連結ユニット60のドアバルブ61

を閉じる。次に、排気系圧力制御バルブ34を閉じてロードロック室50を真空引きする。ロードロック室50の真空引きが終了した後に、(3)に示すように排気系圧力制御バルブ34を開き、連結ユニット40のゲートバルブ41を開く。その後、連結ユニット20のゲートバルブ21を開く。

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0114

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0114】

ロードロック室50が設定圧力に到達した後、ロードロック室50の排気バルブ（図示せず。LLM排気バルブ）を閉じて、PHT排気バルブ34を開き、

ロードロック室50内圧力>PHT処理室30内圧力となるように制御し、制御完了を確認後、ロードロック室50-PHT処理室30間のゲートバルブ41（以下、PHT側ゲートバルブ41）を開いて、ロードロック室50とPHT処理室30とを連通させる。

【手続補正18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0117

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0117】

PHT処理室30内圧力<COR処理室10内圧力

となった時点で、COR処理室10に取り付けられた排気系圧力制御バルブ14（以下、COR排気バルブ14）を閉じ、PHT処理室30-COR処理室10間のゲートバルブ21（以下、COR側ゲートバルブ21）を開く。

【手続補正19】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0119

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0119】

3) 1) に記述のシーケンスでPHT側ゲートバルブ41を開き、ロードロック室50とPHT処理室30とを1モジュールと想定して、(2)に記述のシーケンスでCOR側ゲートバルブ21を開く。PHT側ゲートバルブ41、COR側ゲートバルブ21が開いた後も継続してPHT排気バルブ34を開いておき、排気することにより、PHT処理室30内の雰囲気気がロードロック室50の内部、COR処理室10の内部に回り込むことを防ぐことができる。